

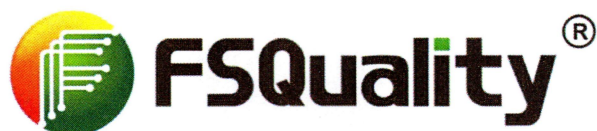
股票简称：四会富仕

股票代码：300852

四会富仕电子科技股份有限公司

Sihui Fuji Electronics Technology Co.,Ltd.

注册地址：四会市下茆镇龙湾村西鸦崙



向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

（注册稿）

保荐人（主承销商）



（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二六年九月

## 声 明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

### 一、提请投资者重点关注的风险

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

#### （一）募投项目收益不及预期的风险

公司本次募集资金用于“年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）”，本次募投项目达产后实现不含税年销售收入 109,206.00 万元，年利润总额（税前）11,937.04 万元。未来整体市场环境、供求关系尚存在不确定性，若在募投项目实施过程中宏观经济、产业政策、市场需求等发生重大不利变化，可能出现行业产能过剩、行业竞争加剧的情形，或者产品技术路线发生重大更替、公司市场开拓不力、无法满足下游客户需求或其他不可抗力因素出现，都可能对公司募投项目投产后的产能消化、产品销售价格和毛利率等造成不利影响，进而可能导致募集资金投资项目实际效益不及预期。

#### （二）新增产能消化风险

公司本次募集资金投向围绕公司 PCB 主业进行布局，旨在增加公司高多层板及 HDI 产能。项目建成达产后，将形成年产 60 万平方米高多层及 HDI 电路板产能。当前较多同行业公司普遍在进行规模扩张，**东山精密、广合科技、沪电股份、鹏鼎控股、胜宏科技、深南电路等头部厂商资本开支呈加速态势，均在同步进行以高多层板和 HDI 板为核心方向的大规模产能建设，积极增加产能，现阶段行业呈现集中扩产态势，产能集中释放的累积效应预计在 2-3 年集中显现，与发行人本次募投项目的投产时间窗口存在一定重叠，未来可能因新增产能陆续释放引发供给过剩而需求不足的风险，可能对募投项目产能消化形成压力。本次募投项目重点布局的服务器和光模块等新兴领域的技术门槛高、存量头部企业先发优势明显，公司短期内实现大规模订单落地的确定性有限。如果**

本次募集资金投资项目建成投产后，PCB 行业出现下游需求增长放缓甚至下滑、行业内同质化竞争加剧、新增产能投产速度过快、重大技术革新并形成替代、下游市场需求发生重大变化、公司客户开拓力度不及预期或其他重大不利变化的情形，可能导致市场需求增长不及预期以及产品推广困难，进而可能导致公司募投项目新增产能无法及时消化，**本次募投项目新增产能的消化面临一定的产能闲置风险。**

### **（三）固定资产折旧增加对公司经营业绩产生不利影响的风险**

公司本次募集资金拟投向“年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）”，公司计划投入较大金额用于设备采购和工程建设等资本性支出。公司本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产较本次发行前将有所增加，**本次募投项目聚焦的高多层板及 HDI 板工艺复杂度高、客户认证壁垒严、良率爬升难度大，产能爬坡周期长达 3 年**，由此带来每年固定资产折旧、无形资产摊销的增长，预计达产年度新增折旧及摊销金额为 7,211.20 万元。**投产初期折旧计提与收入贡献之间存在明显的时间错配，导致投产初期项目利润为负**，募集资金投资项目的建设需要一定的周期，折旧及摊销为固定成本，其对利润的影响具有杠杆效应，在产能利用率不足的情形下，单位产品折旧成本被动抬升，项目盈利空间将被压缩，新增折旧摊销将对发行人盈利能力构成结构性侵蚀，合并报表层面面临利润承压风险。若本次募投项目建设过程中公司经营环境发生重大不利变化或者募投项目建成后经济效益不及预期，募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

### **（四）毛利率波动的风险**

报告期内，公司综合毛利率分别为 27.11%、22.82%、20.77%和 **20.94%**，受行业竞争激烈、泰国子公司一品电路产能爬坡、原材料价格上涨等因素影响，公司综合毛利率整体呈下降趋势。

**2025 年以来，受国际贵金属价格持续上涨、高端电子布产能刚性紧缺等多重因素共振，覆铜板行业进入强景气上行周期，带动整个 PCB 上游材料板块进入系统性涨价周期，在原材料端面临系统性价格上涨的背景下，发行人的成本**

传导机制存在时滞，产品结构转型期高端产品贡献尚在爬坡阶段，如果未来受下游终端客户订单需求变动、议价能力提升、市场竞争加剧等导致公司产品销售价格下降，而公司未能及时通过提高技术水平、产品质量、提高产能利用率以应对市场竞争，或者原材料价格上升，**短期内难以逆转**，而公司未能有效控制产品成本等情况发生，则存在毛利率波动和盈利能力波动**或下滑**的风险。

#### **（五）原材料供应紧张及价格波动风险**

公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、金盐、半固化片、铜箔等，主要原材料价格受国际市场铜、金等大宗商品的影响较大。若未来原材料供应紧张、价格大幅上涨，而公司不能通过提高产品价格向下游客户转嫁原材料涨价成本，或通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，可能出现原材料供应不足或盈利能力下降等情形，将对公司的经营成果产生不利影响。

#### **（六）行业产能大幅扩张导致产品价格下降的风险**

近年来，全球 PCB 产能不断向国内聚集，我国已成为全球印刷线路板的主要生产基地。近几年国内 PCB 产能仍处于快速扩张态势，若未来出现行业产能过剩、行业竞争加剧导致产品价格下滑，公司未能持续提高公司的技术水平、生产管理、产品质量以应对市场竞争，则存在盈利下滑的风险。

#### **（七）应收账款发生坏账的风险**

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 32,033.77 万元、34,202.55 万元、52,415.72 万元和 **62,303.01 万元**，各期末应收账款余额呈现增长趋势，占营业收入的比例分别为 24.37%、24.20%、27.13%和 **50.55%**。随着市场竞争的加剧、经营规模的扩大和新业务的不断开展，公司客户数量及应收账款余额将可能持续增长，如果部分客户出现支付困难、拖延付款等现象，公司将面临无法及时收回货款的风险，从而对公司的资金周转和生产经营产生不利影响。

## **二、关于本次向特定对象发行股票符合发行条件的说明**

根据《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票符合法定的发行条件。

### 三、公司的利润分配政策和现金分红情况

#### （一）公司的利润分配政策

##### 1、利润分配原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定公司的利润分配方案。

##### 2、利润分配形式

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司优先采用现金分红的方式。

##### 3、利润分配的决策程序及机制

（1）公司利润分配政策应由公司董事会向公司股东会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，且经公司二分之一以上独立董事表决通过。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）公司利润分配政策应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司利润分配政策提交公司股东会审议，公司应提供网络形式的投票平台，为社会公众股东方便参与股东会表决提供服务。

##### 4、现金分红的条件及时间、比例

###### （1）现金分红的条件

①如公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④无重大投资计划或重大资金支出发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟购买重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，或者超过 2 亿元人民币。

## （2）现金分红的时间及比例

在符合利润分配原则、在满足正常生产经营的资金需求情况下，保障公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，也可拟订年度利润分配预案时就下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等提出建议方案，下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

## 5、股票股利分配条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证公司股本规模及股

权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

## **6、利润分配政策的调整机制**

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。

## **7、利润分配信息披露机制**

公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合章程的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。

## **（二）公司最近三年现金分红情况**

### **1、2023 年利润分配方案**

经 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司以截至股权登记日总股本并剔除公司回购专用证券账户内股数后的 101,290,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,038.72 万元（含税）；同时公司向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增 40,772,304 股。

### **2、2024 年利润分配方案**

经 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，公司以截至股权登记日总股本并剔除公司回购专用证券账户内股数后的 141,271,053 股为基数，

向全体股东每 10 股派 1.40 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,977.79 万元（含税）。

3、2025 年利润分配方案

经 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，公司以截至股权登记日总股本 160,521,165 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 1.4 元（含税），共分配现金红利 2,247.30 万元（含税），同时，为增厚每股收益，提升股东回报，公司注销回购股份的金额为 3,104.17 万元。

4、最近三年现金分红情况

最近三年，公司现金分红情况如下：

单位：万元

| 项目                          | 2025年     | 2024年     | 2023年     |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 归属于上市公司股东的可分配利润             | 11,524.55 | 12,386.69 | 20,440.09 |
| 现金分红（含税）                    | 2,247.30  | 1,977.79  | 3,038.72  |
| 回购注销金额                      | 3,104.17  | -         | -         |
| 当年合计现金分红金额                  | 5,351.47  | 1,977.79  | 3,038.72  |
| 最近三年累计现金分配合计                | 10,367.99 |           |           |
| 最近三年年均可分配利润                 | 14,783.78 |           |           |
| 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例 | 70.13%    |           |           |

2023 年、2024 年及 2025 年，发行人的分红政策由董事会、股东会审议通过，发行人履行了相应的决策程序，发行人历年分红执行情况符合发行人《公司章程》规定及相关政策要求。

## 目 录

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 声 明 .....                                 | 1  |
| 重大事项提示 .....                              | 2  |
| 一、提请投资者重点关注的风险 .....                      | 2  |
| 二、关于本次向特定对象发行股票符合发行条件的说明 .....            | 4  |
| 三、公司的利润分配政策和现金分红情况 .....                  | 5  |
| 目 录 .....                                 | 9  |
| 第一节 释义 .....                              | 12 |
| 一、常用词汇 .....                              | 12 |
| 二、专业词汇释义 .....                            | 13 |
| 第二节 发行人基本情况 .....                         | 15 |
| 一、发行人基本信息 .....                           | 15 |
| 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 .....                 | 16 |
| 三、发行人所在行业概况 .....                         | 16 |
| 四、发行人主营业务情况 .....                         | 37 |
| 五、现有业务发展安排及未来发展战略 .....                   | 48 |
| 六、截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资 .....           | 50 |
| 七、同业竞争情况 .....                            | 55 |
| 八、未决诉讼、仲裁及行政处罚等相关情况 .....                 | 57 |
| 九、报告期内交易所对发行人年度报告的问询情况 .....              | 59 |
| 第三节 本次证券发行概要 .....                        | 60 |
| 一、本次发行的背景和目的 .....                        | 60 |
| 二、发行对象与发行人的关系 .....                       | 64 |
| 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 .....             | 65 |
| 四、募集资金数额及用途 .....                         | 66 |
| 五、本次发行是否构成关联交易 .....                      | 67 |
| 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .....                | 67 |
| 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .....    | 67 |
| 八、本次证券发行满足“两符合”和不涉及“四重大”相关规定 .....        | 68 |
| 九、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据及融资间隔相关情况 ..... | 69 |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 十、因实施募投项目而新增的折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响 ..                                            | 70        |
| <b>第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....</b>                                          | <b>72</b> |
| 一、本次募集资金使用计划 .....                                                            | 72        |
| 二、本次募集资金投资项目的具体情况 .....                                                       | 72        |
| 三、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式 .....                                                    | 81        |
| 四、本次募投项目相关既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性 .....                               | 83        |
| 五、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响 .....                                                   | 85        |
| 六、募投项目实施后新增同业竞争或关联交易的情况 .....                                                 | 86        |
| 七、募集资金投资项目涉及报批事项情况 .....                                                      | 86        |
| 八、募集资金投资项目可行性分析结论 .....                                                       | 86        |
| <b>第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....</b>                                         | <b>87</b> |
| 一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 .....                         | 87        |
| 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .....                                          | 88        |
| 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 .....                             | 88        |
| 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 ..... | 89        |
| 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 .....        | 89        |
| <b>第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况 .....</b>                                             | <b>90</b> |
| 一、最近五年内募集资金运用的基本情况 .....                                                      | 90        |
| 二、前次募集资金基本情况 .....                                                            | 90        |
| 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 .....                                                      | 91        |
| 四、尚未使用的前次募集资金的后续使用计划 .....                                                    | 92        |
| 五、前次募集资金投资项目变更情况 .....                                                        | 92        |
| 六、闲置募集资金的使用情况 .....                                                           | 92        |
| 七、会计师事务所出具的专项报告结论 .....                                                       | 93        |
| 八、超过五年的前次募集资金用途变更情况 .....                                                     | 93        |
| <b>第七节 与本次发行相关的风险因素 .....</b>                                                 | <b>94</b> |
| 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的                                              |           |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 因素 .....                               | 94         |
| 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 .....           | 97         |
| 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ..... | 98         |
| <b>第八节 与本次发行相关的声明 .....</b>            | <b>101</b> |
| 一、发行人及全体董事、高级管理人员声明 .....              | 101        |
| 二、发行人控股股东、实际控制人声明 .....                | 103        |
| 三、保荐人（主承销商）声明 .....                    | 104        |
| 四、发行人律师声明 .....                        | 107        |
| 五、审计机构声明 .....                         | 108        |
| 六、发行人董事会声明 .....                       | 109        |

## 第一节 释义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

### 一、常用词汇

|                      |   |                                                                |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 四会富仕、发行人、公司、本公司      | 指 | 四会富仕电子科技有限公司                                                   |
| 四会明诚                 | 指 | 四会市明诚贸易有限公司，发行人控股股东                                            |
| 天诚同创                 | 指 | 四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙），发行人股东                                       |
| 一鸣投资                 | 指 | 四会市一鸣投资有限公司，发行人股东                                              |
| 富仕技术                 | 指 | 四会富仕技术有限公司，公司全资子公司，已于 2026 年 2 月注销并被公司吸收合并                     |
| 香港富仕                 | 指 | 四会富仕电子（香港）有限公司，公司全资子公司                                         |
| 日本富仕                 | 指 | 四会富仕日本株式会社，注册地为日本，香港富仕投资控股子公司                                  |
| ELECBRIGHT SOLUTIONS | 指 | ELECBRIGHT SOLUTIONS PTE. LTD. 注册地为新加坡，公司全资子公司                 |
| 一品电路                 | 指 | 一品电路有限公司，注册地为泰国，公司与香港富仕、ELECBRIGHT SOLUTIONS PTE. LTD 合资的控股子公司 |
| 富仕电子                 | 指 | 富仕电子技术（广州）有限公司，公司全资子公司                                         |
| 富仕进出口                | 指 | 四会富仕进出口贸易有限公司，公司全资子公司                                          |
| 美国富仕                 | 指 | Fuji Innovation Inc. 注册地为美国，一品电路全资子公司                          |
| 保荐机构（主承销商）           | 指 | 国联民生证券承销保荐有限公司                                                 |
| 发行人律师                | 指 | 北京观韬律师事务所                                                      |
| 会计师、立信会计师事务所         | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                               |
| 本次向特定对象发行 A 股股票/本次发行 | 指 | 四会富仕电子科技有限公司拟向特定对象发行 A 股股票                                     |
| A 股                  | 指 | 每股面值 1.00 元人民币之普通股                                             |
| 元、万元                 | 指 | 人民币元、人民币万元                                                     |
| 定价基准日                | 指 | 本次向特定对象发行 A 股股票发行期首日                                           |
| 公司法                  | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                   |
| 证券法                  | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                   |
| 证监会或中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                    |
| 深交所                  | 指 | 深圳证券交易所                                                        |
| 《境外法律意见书》            | 指 | 境外律师出具的香港法律意见书、日本法律意见书及泰国法律意见书的合称                              |

|             |   |                                    |
|-------------|---|------------------------------------|
| 报告期、最近三年及一期 | 指 | 2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月 |
|-------------|---|------------------------------------|

二、专业词汇释义

|               |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 印制电路板/PCB     | 英文全称“Printed Circuit Board”，指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，又可称为“印制线路板”、“印刷线路板”                                                                                                                                       |
| 单面板           | 指仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的 PCB                                                                                                                                                                                           |
| 双面板           | 指在基板两面形成导体图案的 PCB                                                                                                                                                                                                             |
| 多层板           | 指使用数片单面或双面板，并在每层板间放进一层绝缘层后压合的 PCB                                                                                                                                                                                             |
| 刚性板           | 指由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，具有抗弯能力，可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑，又称“硬板”                                                                                                                                                                 |
| 挠性板           | 指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板，并具有一定弯曲性的印制电路板，又称“软板”、“柔性板”                                                                                                                                                                                 |
| 刚挠结合板         | 刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求，又称“软硬结合板”                                                                                                                                                                     |
| 厚铜板           | 使用厚铜箔（铜厚在3盎司及以上）或成品任何一层铜厚为3盎司及以上的印制电路板                                                                                                                                                                                        |
| HDI 板         | HDI 是 High Density Interconnect 的缩写，即高密度互连技术。HDI 是印制电路板技术的一种，是随着电子技术更趋精密化发展演变出来用于制作高精密电路板的一种方法，可实现高密度布线，一般采用积层法制造。HDI 板通常指孔径在 0.15mm(6mil)以下(大部分为盲孔)、孔环之环径在 0.25mm(10mil)以下的微孔，接点密度在 130 点/平方英寸以上，布线密度在 117 英寸/平方英寸以上的多层印制电路板 |
| 金属基板          | 指由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制线路板                                                                                                                                                                                                 |
| 陶瓷基板          | 指铜箔在高温下直接键合到氧化铝或氮化铝陶瓷基片表面上的特殊工艺电路板，具有优良电绝缘性能，高导热特性，高附着强度，具有很大的载流能力                                                                                                                                                            |
| 高频高速板         | 指在特殊的高频覆铜板上利用普通刚性线路板制造方法的部分工序或者采用特殊处理方法而生产的印制电路板，用于高频率与高速传输领域                                                                                                                                                                 |
| 覆铜板/基板/基材/CCL | 指 Copper Clad Laminate，简称 CCL，为制造 PCB 的基本材料，具有导电、绝缘和支撑等功能，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基材）和柔性材料两大类                                                                                                                             |
| 半固化片          | 又称为“PP 片”或“树脂片”，是制作多层板的主要材料，主要由树脂和增强材料组成，增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型。制作多层印制板所使用的半固化片大多采用玻纤布做增强材料                                                                                                                                  |
| 电镀            | 指一种电离子沉积过程，利用电极通过电流，使金属附着在物体表面上，其目的为改变物体表面的特性或尺寸                                                                                                                                                                              |
| EMS 企业        | 电子制造服务商（Electronics Manufacturing Service），指为电子产品类客户提供包括产品设计、代工生产等服务的厂商                                                                                                                                                       |
| “阿米巴”经营       | 日本企业家及哲学家稻盛和夫创立的一种国际先进的企业管理模式。指将组织划小自主经营单元，进行独立核算，通过对自主经营单元负责人进行充分授权，建立与其经营目标达成情况直接关联的激励机制，实现全员参与经营                                                                                                                           |

|          |                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS     | 指 Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment，即《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》 |
| WECC     | 指世界电子电路联盟，World Electronic Circuits Council 的缩写，是由全球各电路板产业协会所组成的跨国组织                                                      |
| CPCA     | 指中国电子电路行业协会（China Printed Circuit Association）                                                                            |
| Prismark | 指美国 Prismark Partners LLC，是印制电路板及其相关领域知名的市场分析机构，其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力                                                      |
| 光模块      | 又称光收发一体模块，是实现光通信系统中光信号和电信号转换的核心部件，主要由光器件、功能电路和光接口等构成                                                                      |
| 盲孔       | 将 PCB 任意相邻层以电镀孔连接的称为盲孔                                                                                                    |
| IDC      | 国际数据集团（IDG）的全资子公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商                                                                      |

本募集说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称      | 四会富仕电子科技股份有限公司                                                                                                                                            |
| 英文名称      | Sihui Fuji Electronics Technology Co.,Ltd.                                                                                                                |
| 成立日期      | 2009 年 8 月 28 日（2018 年 6 月 7 日整体变更为股份有限公司）                                                                                                                |
| 上市日期      | 2020 年 07 月 13 日                                                                                                                                          |
| 股票上市地     | 深圳证券交易所                                                                                                                                                   |
| 股票简称      | 四会富仕                                                                                                                                                      |
| 股票代码      | 300852                                                                                                                                                    |
| 法定代表人     | 刘天明                                                                                                                                                       |
| 董事会秘书     | 黄倩怡                                                                                                                                                       |
| 注册地址      | 四会市下茆镇龙湾村西鸦崙                                                                                                                                              |
| 注册地址的邮政编码 | 526236                                                                                                                                                    |
| 办公地址      | 四会市下茆镇四会电子产业园2号                                                                                                                                           |
| 办公地址的邮政编码 | 526236                                                                                                                                                    |
| 注册资本      | 16,052.1165 万元（截至 2026 年 6 月 30 日）                                                                                                                        |
| 电话        | 0758-3106018                                                                                                                                              |
| 传真        | 0758-3527308                                                                                                                                              |
| 电子邮箱      | stock@fujipcb.cn                                                                                                                                          |
| 网址        | www.fujipcb.cn                                                                                                                                            |
| 经营范围      | 研发、制造、销售：双面、多层、刚挠结合、金属基、高频、HDI、元件嵌入式等电路板；电路板设计；电路板表面元件贴片、封装；自动化产品的研发、生产、销售；新型材料的研发、生产、销售；国内贸易；货物的进出口、技术进出口。（以上项目不含工商登记前置审批事项）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

## 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

### （一）股本结构

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称                          | 股本性质    | 持股总数<br>(股) | 持股比例   | 其中有限售条件股数(股) |
|----|-------------------------------|---------|-------------|--------|--------------|
| 1  | 四会市明诚贸易有限公司                   | 境内非国有法人 | 53,258,484  | 33.18% | -            |
| 2  | 四会天诚同创投资合伙企业<br>(有限合伙)        | 境内非国有法人 | 14,095,700  | 8.78%  | -            |
| 3  | 四会市一鸣投资有限公司                   | 境内非国有法人 | 13,857,480  | 8.63%  | -            |
| 4  | 刘天明                           | 境内自然人   | 3,709,912   | 2.31%  | 2,782,434    |
| 5  | 温一峰                           | 境内自然人   | 3,709,894   | 2.31%  | 2,782,420    |
| 6  | 广东惠正私募基金管理有限公司－惠正平稳私募证券投资基金   | 其他      | 1,854,278   | 1.16%  | -            |
| 7  | 东莞信托有限公司－东莞信托·汇信－惠正稳健集合资金信托计划 | 其他      | 1,810,380   | 1.13%  | -            |
| 8  | 沈勇                            | 境内自然人   | 1,803,356   | 1.12%  | -            |
| 9  | 香港中央结算有限公司                    | 境外法人    | 1,499,589   | 0.93%  | -            |
| 10 | 高盛国际－自有资金                     | 境外法人    | 844,614     | 0.53%  | -            |
| 合计 |                               |         | 96,443,687  | 60.08% | 5,564,854    |

### （二）控股股东及实际控制人

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的控股股东为四会明诚，持有公司 33.18% 股份；刘天明、温一峰和黄志成通过四会明诚、天诚同创、一鸣投资合计控制发行人 50.59% 的股份；刘天明直接持有公司 2.31% 的股份；温一峰直接持有公司 2.31% 的股份；刘天明、温一峰和黄志成共同控制公司 55.21% 的股份，为共同实际控制人。

### （三）主要股东所持发行人股份的重大权属纠纷情况

截至 2026 年 6 月 30 日，持有发行人股份 5% 以上的主要股东及实际控制人所持发行人股份不存在重大权属纠纷，不存在股份质押的情况。

## 三、发行人所在行业概况

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，公司专注于印制电路板

中小批量板的制造，以“高品质、高可靠、短交期、快速响应”为市场定位，产品广泛应用于工业控制、汽车电子、消费电子、通信设备、医疗器械等领域。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3982 电子电路制造”。

## （一）所处行业的主要特点

### 1、行业监管体制和主要法律法规及政策

#### （1）行业主管部门

中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）是印制电路板行业的主管部门，其主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

#### （2）行业自律组织

中国电子电路行业协会（以下简称“CPCA”）是行业自律组织，隶属工信部业务主管领导的具有独立法人资格的国家一级行业协会。公司是协会理事单位之一。CPCA 以推进印制电路行业的改革与发展、加速印制电路行业的现代化建设为宗旨，主要职能包括：向政府反映企事业单位的愿望和要求，向企事业单位传达政府的政策和意图，协助政府部门对印制电路行业进行行业管理；向政府部门提出制定行业规划、经济和技术政策、技术标准及经济立法等方面的建议，并参与相应活动；向有关部门和会员单位提供情况、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作等。

#### （3）最近三年行业主要政策及法律法规

印制电路板在连接各种元器件中起着关键作用，是现代电子设备的重要组成部分。电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，印制电路板作为电子信息产业的基础产品，国家相继推出了一系列扶持和鼓励

印制电路板行业发展的产业政策，从而推进行业的产业升级及战略性调整。我国支持印制电路板产业发展的有关政策，具体如下：

| 序号 | 时间          | 部门              | 政策名称                           | 有关内容                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2025 年 11 月 | 工信部             | 《印制电路板行业规范条件》（2025 年）          | 推动印制电路板产业高端化、绿色化、智能化发展，引导产业加快转型升级                                                                                                                                                                       |
| 2  | 2025 年 10 月 | 中国共产党中央委员会      | 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》 | 完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。                                                                                                                                |
| 3  | 2025 年 8 月  | 工信部             | 《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》   | 持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新。提升协同攻关效率，支持人工智能、先进存储、三维异构集成芯片、全固态电池等前沿技术方向基础研究。                                                                                                                      |
| 4  | 2025 年 4 月  | 工信部             | 《电子信息制造业数字化转型实施方案》             | 重点支持新一代信息通信、集成电路、先进电池材料等作为主导产业的国家高新区及其他重点园区，加快先进计算中心、新一代移动通信、工业互联网等新型基础设施规模化建设应用。深化先进计算、智能控制、人机交互、大数据等技术在人工智能终端产品中的应用，加快发展智能传感器、智能移动终端、智能语音交互系统、智能可穿戴设备等。                                               |
| 5  | 2024 年 2 月  | 国务院办公厅          | 《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》   | 积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策                                                                                                                                                       |
| 6  | 2024 年 1 月  | 工信部、教育部、科技部等七部门 | 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》            | 加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机、绿色智能船舶、无人船艇等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系。深入实施产业基础再造工程，补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板，夯实未来产业发展根基。                                                       |
| 7  | 2023 年 12 月 | 国家发改委           | 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》          | 属于鼓励类目录中的“二十八、信息产业·5、新型电子元器件制造：片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板、高密度高细线路（线宽/线距≤0.05mm）柔性电路板、太阳能电池、锂离子电池、钠离子电池、燃料电池等化学与物理电池等” |

|    |             |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 2023 年 11 月 | 中国算力大会                     | 《中国存力白皮书（2023 年）》   | 战略上，继续重视数据存储，构建良好的存储行业生态；技术上，全面加快技术创新，推动先进存力的研发部署，产业上，鼓励国产设备应用，提升存力的安全保障能力；标准上，完善产业标准体系，促进产业的健康蓬勃发展。                                                                                                                                                                     |
| 9  | 2023 年 10 月 | 工信部等六部门                    | 《算力基础设施高质量发展行动计划》   | 强化存力高效灵活保障：加速存力技术研发应用、持续提升存储产业能力、推动存算网协同发展。存储力方面，存储总量超过 1800EB，先进存储容量占比达到 30% 以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%。                                                                                                                                                              |
| 10 | 2023 年 6 月  | 工信部、教育部、科技部、财政部、国家市场监督管理总局 | 《制造业可靠性提升实施意见》      | 聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。提升高频高速印刷电路板及基材、新型显示专用材料、高效光伏电池材料、锂电关键材料、电子浆料、电子树脂、电子化学品、新型显示电子功能材料、先进陶瓷基板材料、电子装联材料、芯片先进封装材料等电子材料性能，提高元器件封装及固化、外延均匀、缺陷控制等工艺水平，加强材料分析、破坏性物理分析、可靠性试验分析、板级可靠性分析、失效分析等分析评价技术研发和标准体系建设，推动在相关行业中的应用。 |
| 11 | 2023 年 2 月  | 中共中央、国务院                   | 《数字中国建设整体布局规划》      | 夯实数字中国建设基础。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。                                                                                                                                                                                             |
| 12 | 2023 年 1 月  | 工信部等六部门                    | 《关于推动能源电子产业发展的指导意见》 | 加强面向新能源领域的关键信息技术产品开发和应用，主要包括适应新能源需求的电力电子、柔性电子、传感物联、智慧能源信息系统及有关的先进计算、工业软件、传输通信、工业机器人等适配性技术及产品。                                                                                                                                                                            |
| 13 | 2022 年 3 月  | 国务院                        | 《2022 年政府工作报告》      | 鼓励促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。                                                                                                                                      |
| 14 | 2022 年 3 月  | 工信部                        | 《2022 年汽车标准化工作要点》   | 开展汽车企业芯片需求及汽车芯片产业技术能力调研，联合集成电路、半导体器件等关联行业研究发布汽车芯片标准体系。推进 MCU 控制芯片、感知芯片、通信芯片、存储芯片、安全芯片计算芯片和新能源汽车专用芯片等标准研究和立项。                                                                                                                                                             |

|    |             |                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 2022 年 1 月  | 国务院                                   | 《“十四五”数字<br>经济发展规划》                       | 着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平。加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。                                                                                                                                            |
| 16 | 2021 年 12 月 | 中 央 网<br>络 安 全<br>和 信 息<br>化 委 员<br>会 | 《“十四五”国家信<br>息化规划》                        | 加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。                                                                                                                                              |
| 17 | 2021 年 11 月 | 工信部                                   | 《“十四五”大数据<br>产业发展规划》                      | 梳理数据生成、采集、存储、加工、分析、服务、安全等关键环节大数据产品，建立大数据产品图谱                                                                                                                                                                                               |
| 18 | 2021 年 11 月 | 工信部                                   | 《“十四五”信息通<br>信 行 业 发 展 规<br>划》            | 构建国家新型数字基础设施、提供网络和信息<br>服务、全面支撑经济社会发展的战略性、<br>基础性和先导性行业。提出行业高质量发<br>展新思路，设定 6 大类 20 个量化发展目标；<br>确定了五个方面 26 项发展重点和 21 项重点<br>工程。                                                                                                            |
| 19 | 2021 年 7 月  | 工信部                                   | 《新型数据中<br>心发展三年行<br>动计划（2021-2023）》       | 积极构建城市内的边缘算力供给体系，支撑<br>边缘数的计算、存储和转发，满足极低时延<br>的新型业务应用需求；基于业务场景，匹配<br>边缘数据中心计算和存储能力。                                                                                                                                                        |
| 20 | 2021 年 1 月  | 工信部                                   | 《基础电子元<br>器件产业发展<br>行动计划（2021-2023<br>年）》 | 重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电<br>连接器，超高速、超低损耗、低成本的光纤<br>光缆，耐高压、耐高温、高抗拉强度电气装<br>备线缆，高频高速、高层高密度印制电路<br>板、集成电路封装基板、特种印制电路板；<br>抢抓全球 5G 和工业互联网契机，围绕 5G<br>网络、工业互联网和数据中心建设，重点推<br>进射频阻容元件、中高频元器件、特种印<br>制电路板、高速传输线缆及连接组件、光通<br>信器件等影响通信设备高速传输的电子元<br>器件应用 |

## 2、行业发展现状和发展趋势

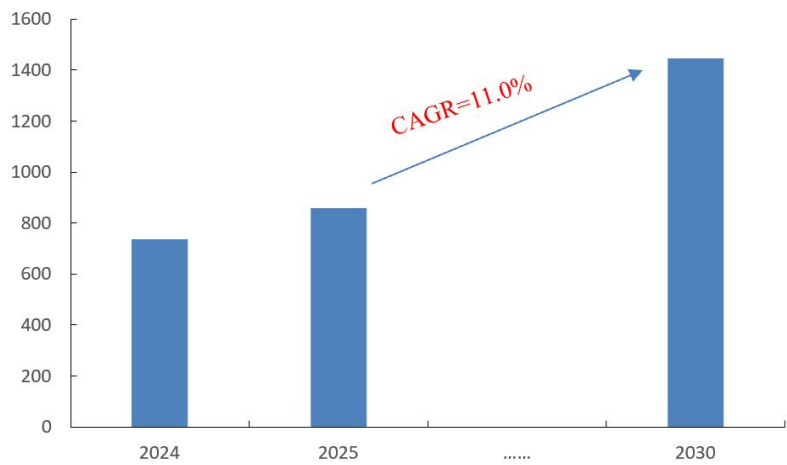
### （1）全球印制电路板发展概况

PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业。**2024 年**，全球 PCB 产值为 **735.65 亿美元**。**2025 年**，受益于 AI 服务器、人工智能、高速通信、数据/存储、算力设施、智能驾驶及相关高速网络基础设施推动等，全球 PCB 产值达到 **858.36 亿美元**，同比增长 **16.7%**。

未来在低碳化、智能化等因素的驱动下，5G 通信、云计算、智能手机、智能汽车、新能源汽车等 PCB 下游应用行业预期将蓬勃发展，下游应用行业的蓬勃发展将带动 PCB 需求的持续增长。根据 Prismark 的预测，未来五年全球 PCB

市场将保持稳定增长，2025 年至 2030 年全球 PCB 产值的预计年复合增长率达 11.0%，至 2030 年预计全球 PCB 市场将达到 1,446.10 亿美元。2024 年至 2030 年，全球 PCB 行业产值及其变化情况如下图所示：

2024-2030 年全球 PCB 产值及增长率



数据来源：Prismark

①全球 PCB 产业向亚洲特别是中国大陆转移

PCB 产业在全球范围内广泛分布，美欧日发达国家和地区起步早。2000 年以前，美洲、欧洲和日本三大地区占据全球 PCB 产值的 70%以上。但近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国大陆、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移，PCB 行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自 2006 年开始，中国大陆超越日本成为全球第一大 PCB 生产基地，PCB 的产量和产值均居世界第一。全球 PCB 产业迁移情况及预计增长率情况如下：

单位：亿美元

| 国家和地区         | 2025年  | 2030年（F） | 预计复合年均增长率 |
|---------------|--------|----------|-----------|
| 中国大陆          | 496.52 | 817.64   | 10.5%     |
| 亚洲（不含中国大陆/日本） | 241.14 | 447.62   | 13.2%     |
| 日本            | 64.99  | 105.07   | 10.1%     |
| 美洲            | 37.96  | 50.81    | 6.0%      |
| 欧洲            | 17.74  | 24.96    | 7.1%      |
| 合计            | 858.36 | 1,446.10 | 11.0%     |

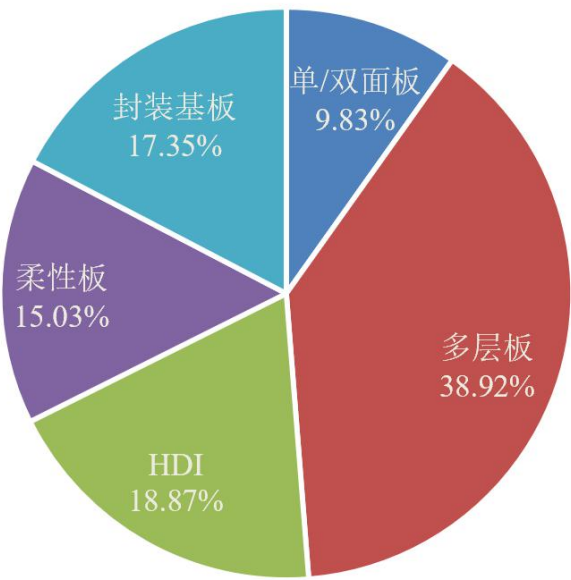
数据来源：Prismark

中国大陆 PCB 产值占全球 PCB 总产值的比例已由 2000 年的 8.1% 上升至 2025 年的 **57.85%**，成为全球 PCB 主要生产供应地。据 Prismark 预测，未来五年亚洲将继续主导全球 PCB 市场的发展，而中国的核心地位更加稳固，中国大陆 PCB 行业预计复合年均增长率为 **10.5%**，至 **2030 年** 行业总产值将达到 **817.64 亿美元**。

②全球 PCB 产品结构及变化趋势

根据 Prismark 的数据，**2025 年** 全球 PCB 细分产品的市场结构如下：

2025 年全球 PCB 细分产品结构



数据来源：Prismark

从产品结构来看，刚性板占市场主流地位，其中多层板占比 **38.92%**，单/双面板占比 **9.83%**；封装基板占比达 **17.35%**；HDI 板和柔性板分别占比为 **18.87%** 和 **15.03%**。

随着电子电路行业技术的迅速发展，终端应用产品呈现小型化、智能化趋势，市场对高密度、高多层、高技术 PCB 产品的需求将变得更为突出，HDI 板、封装基板等技术含量更高的产品增长速度将更快，未来在 PCB 行业中占比将进一步提升。根据 Prismark 预测，**2025 年至 2030 年** 全球 PCB 产品细分领域增长情况如下所示：

单位：亿美元

| 产品类型 | 2025年 | 2030年（F） | 预计复合年均增长率 |
|------|-------|----------|-----------|
|------|-------|----------|-----------|

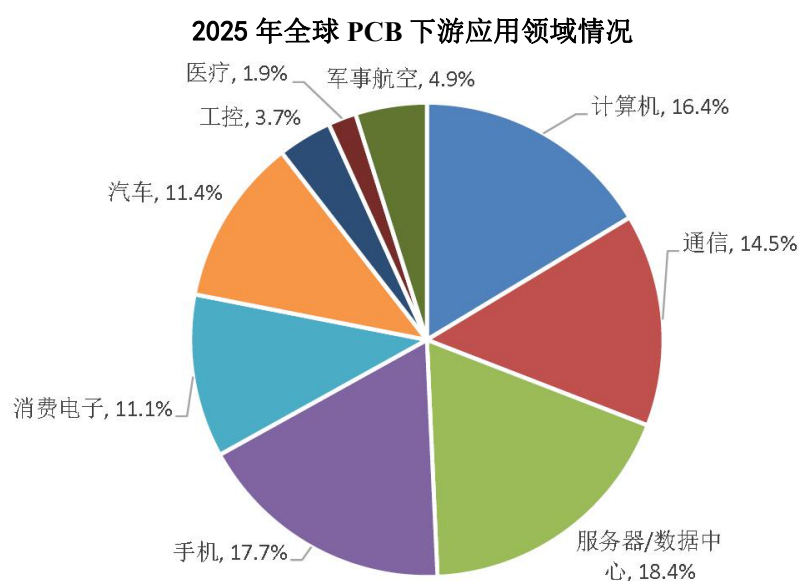
|       |        |          |       |
|-------|--------|----------|-------|
| 单/双面板 | 84.40  | 103.44   | 4.2%  |
| 高多层板  | 334.05 | 585.63   | 11.9% |
| HDI板  | 161.97 | 300.10   | 13.1% |
| 柔性板   | 129.03 | 160.83   | 4.5%  |
| 封装基板  | 148.91 | 296.10   | 14.7% |
| 合计    | 858.36 | 1,446.10 | 11.0% |

数据来源：Prismark

如上表所示，高端 PCB 产品如高多层板、HDI 板增速较快。未来无线通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是 PCB 行业长期的重要增长驱动力。为适应不同领域的需求，PCB 正向着高速、高频、集成化、小型化和轻薄化的方向发展，高多层、高频高速、HDI 板、IC 载板等中高端 PCB 产品将保持强劲增长趋势。2030 年高多层板、HDI 板的市场规模将分别达到 585.63 亿美元、300.10 亿美元，2025–2030 年的复合增长率分别为 11.9%、13.1%。

### ③全球 PCB 下游应用领域

全球 PCB 下游应用领域分布广泛，主要包括通信、计算机、消费电子、汽车电子、服务器、工业控制、军事航空、医疗等领域。根据 Prismark 的统计，2025 年全球 PCB 下游应用领域分布如下：



数据来源：Prismark

PCB 行业的成长与下游电子信息产业的发展密切相关，两者相互促进。随

着大数据、云计算、5G 通信等新一代信息技术的发展，对数据存储和计算力的需求呈高增长态势，服务器行业发展空间广阔。随着新能源汽车的不断普及和汽车电动智能化程度的持续加深，汽车电子行业预计迎来高增长。

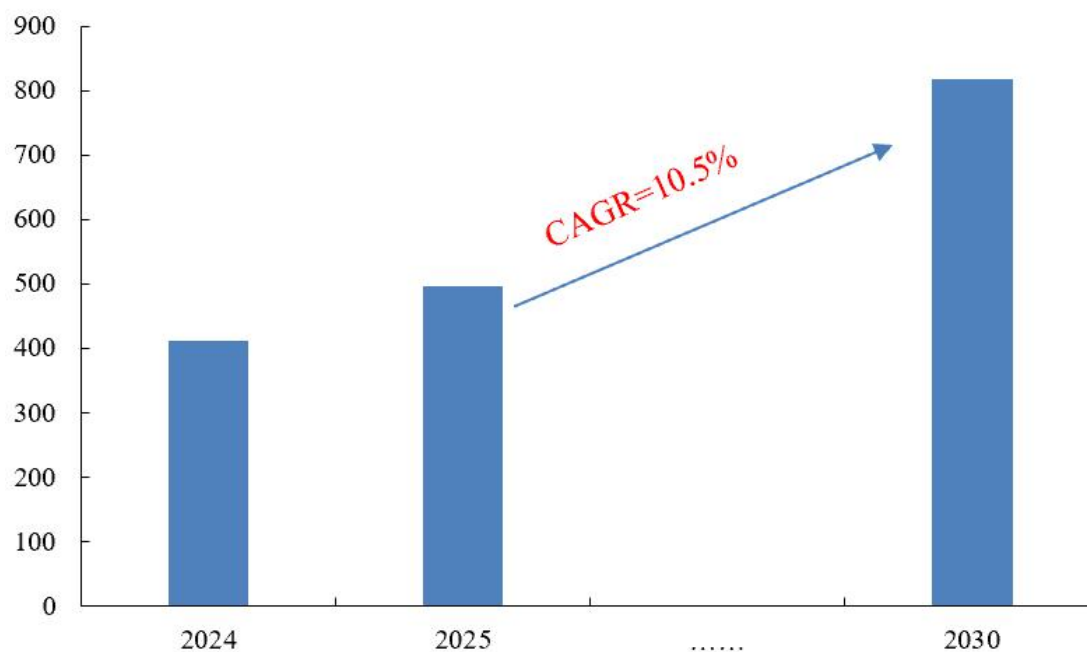
## （2）中国大陆印制电路板发展概况

### ①中国大陆 PCB 市场增长迅速，已成为全球最大生产基地

受益于全球 PCB 产能向中国大陆转移以及下游电子终端产品制造业蓬勃发展，中国大陆 PCB 行业整体呈现较快的增长趋势，2006 年中国大陆 PCB 产值超过日本，成为全球第一大 PCB 制造基地。2024 年，中国大陆 PCB 行业产值为 412.13 亿美元。2025 年，PCB 行业景气度持续上行，中国大陆 PCB 行业产值为 496.52 亿美元，较上年增长约 20.48%。

据 Prismark 预测，未来五年中国大陆 PCB 行业仍将持续增长，预计 2025 年至 2030 年复合年均增长率为 10.5%，2030 年中国大陆 PCB 产值将达到 817.64 亿美元。

2024-2030 年中国大陆 PCB 产值及增长率



数据来源：Prismark

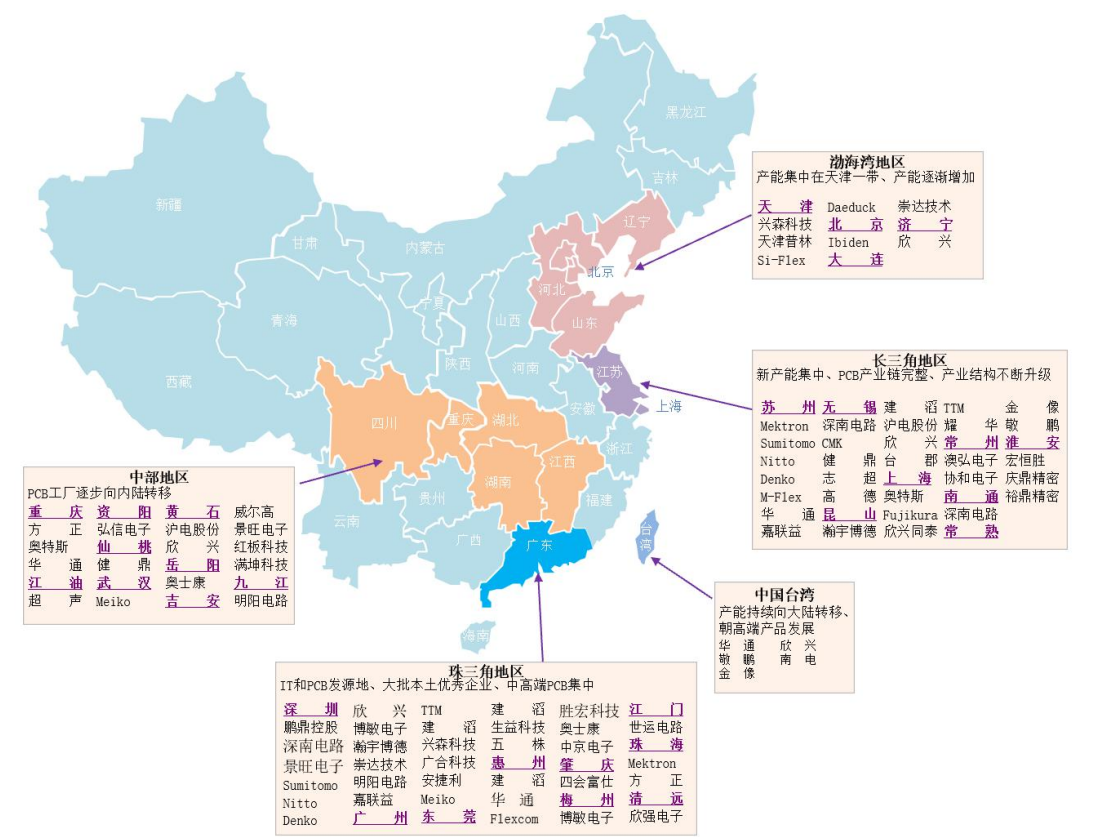
### ②中国 PCB 产业区域分布

中国的改革开放从沿海地区起步，沿海地区凭借国家政策支持、便利的基础交通设施、完善的配套产业链以及劳动力优势，成为电子制造行业崛起的试

验田，PCB 作为电子制造行业的基础部件，也率先在长三角、珠三角等沿海发达地区起步。近年来，随着长三角、珠三角地区劳动力成本的上升和环保排污指标总量控制等政策，以及内地不断提高的产业链配套服务水平，部分 PCB 生产企业开始将部分产能转移至具备产业链配套条件的内地城市，如江西、湖北、湖南、四川、重庆等地。

江西省作为唯一一个与长三角、珠三角和闽南三角区毗邻的省份，是沿海城市向中部地区延伸的重要地带，在我国产业竞争格局中拥有独特的区位优势和资源优势，加上地方政府大力推动 PCB 相关产业招商引资，电子信息产业集群已初具规模，PCB 产能呈现快速增长的发展势头，江西省逐渐成为沿海城市 PCB 企业主要转移基地。未来中西部地区将有望建立完善的 PCB 产业链，发展成为我国 PCB 行业主要的生产制造基地，同时推动珠三角、长三角地区向高端应用产品和高技术附加值产品发展。

目前，我国主要 PCB 生产商及其分布如下：



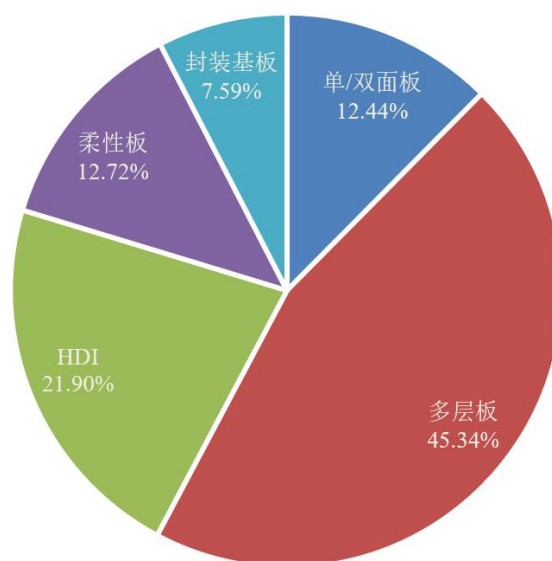
资料来源：公开资料整理

③中国大陆 PCB 细分产品结构

根据 Prismark 数据，2025 年我国刚性板的市场规模最大，其中多层板占比 45.34%，单/双面板占比 12.44%；其次是 HDI 板，占比达 21.90%；柔性板和封装基板占比分别为 12.72%和 7.59%。

从中长期来看，人工智能服务器、高速网络和汽车系统的强劲需求将继续支持高端 HDI、高多层板细分市场的增长，Prismark 预测 2025–2030 年中国大陆多层板、HDI 板的年均复合增长率分别为 11.9%、13.1%。

2025 年中国大陆 PCB 细分产品结构



资料来源：prismark

### （3）小批量板行业发展概况

小批量板行业的下游应用领域主要包括工业控制、交通、通信设备、医疗器械、汽车电子等领域，其中：通信设备、汽车电子领域对大批量板与小批量板均有需求。

小批量板行业的产品个性化程度高，有批量小、品种多、订单持续的特点。下游领域的持续发展使得小批量板市场的需求稳步增长；同时，近年来消费者个性化需求增加，使得消费电子、计算机等领域对小批量的需求逐渐增加。

目前中国小批量板市场发展程度不如欧美、日本等国际市场，但是，中国优势小批量板企业已开始承接较多日本、欧美客户小批量板的订单。未来随着境内市场产业逐步升级，中国小批量板企业竞争力的提升，欧美及日本小批量板产能将继续加速向境内转移，上下游行业的快速发展为小批量行业的发展提

供广阔的市场空间。

（二）行业竞争情况

1、行业竞争格局及行业内主要企业

（1）全球主要 PCB 企业情况

全球 PCB 行业分布地区主要为中国大陆、中国台湾、日本、韩国和欧美地区，目前中国是全球 PCB 行业产量最大的区域。

全球印制电路板行业集中度不高，生产商众多，市场竞争充分。虽然目前 PCB 行业存在向优势企业集中的发展趋势，但在未来较长时期内仍将保持较为分散的行业竞争格局。根据 Prismark 统计，2025 年全球前十大 PCB 厂商收入合计为 323.91 亿美元。2025 年全球前十大 PCB 厂商的销售情况如下：

2025 年全球前十大 PCB 厂商

单位：亿美元

| 排名 | 公司名称                           | 国家/地区 | 营业收入   | 基本情况                                                                        |
|----|--------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ZD Tech（臻鼎）                    | 中国台湾  | 58.69  | 富士康集团成员企业，主营柔性板、HDI 板、刚性板及封装基板                                              |
| 2  | Unimicron（欣兴）                  | 中国台湾  | 42.25  | 主营封装基板、HDI 板、多层板等                                                           |
| 3  | Dongshan Precision（东山精密）       | 中国大陆  | 35.70  | 2016 年完成对 FPC 厂商 MFLX 的私有化收购，2018 年完成对伟创力下属 PCB 业务主体 Multek 的收购，目前主营柔性板、刚性板 |
| 4  | Shennan Circuit（深南电路）          | 中国大陆  | 32.95  | 内资厂商，A 股上市公司，主营印制电路板、电子装联、封装基板，生产基地分布在深圳、无锡、南通、广州                           |
| 5  | TTM Technologies（迅达）           | 美国    | 29.06  | 北美最大的电路板厂商，主营刚性板、HDI 板、柔性板等                                                 |
| 6  | WUS Group（沪电）                  | 中国大陆  | 27.60  | 主营单双面板、多层及 HDI 板                                                            |
| 7  | Victory Giant Technology（胜宏科技） | 中国大陆  | 26.86  | 内资厂商，A 股上市公司，主营产品为刚性电路板、柔性电路板、HDI 板等，生产基地分布在惠州。                             |
| 8  | Compeq（华通）                     | 中国台湾  | 24.46  | 主营多层刚性板、HDI 板、软板与刚柔结合板等                                                     |
| 9  | Tripod（健鼎）                     | 中国台湾  | 23.61  | 主营多层刚性板等                                                                    |
| 10 | Nippon Mektron（旗胜）             | 日本    | 22.73  | 全球最大柔性板厂商                                                                   |
| 合计 |                                |       | 323.91 | -                                                                           |

数据来源：Prismark

（2）中国主要 PCB 企业情况

从中国大陆市场来看，PCB 企业大约有 1,500 家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，形成了中国台资、中国港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，生产技术和产品专业性都有一定优势；内资企业数量众多，产业集中度低，在规模和技术水平上与外资相比仍存在差距。

根据 CPCA 公布的中国电子电路行业排行榜，2025 年中国大陆主要 PCB 厂商排名如下：

2025 年中国大陆 PCB 企业排名

单位：亿元

| 序号 | 公司名称           | 营业收入     | 基本情况                                                        |
|----|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | 391.47   | 臻鼎的控股子公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在深圳、淮安、秦皇岛和营口 |
| 2  | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 256.20   | 内资厂商，A 股上市公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在苏州、盐城和珠海 |
| 3  | 深南电路股份有限公司     | 236.47   | 内资厂商，A 股上市公司，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，生产基地分布在深圳、无锡、南通    |
| 4  | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 192.92   | 内资厂商，A 股上市公司，主营产品为刚性电路板、柔性电路板、HDI 板等，生产基地分布在惠州。             |
| 5  | 沪士电子股份有限公司     | 189.45   | 中国台资控股厂商，A 股上市公司，主营单双面板、多层及 HDI 板，其大陆生产基地分布在昆山、黄石           |
| 6  | 健鼎科技股份有限公司     | 153.52   | 中国台资控股厂商，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在无锡、仙桃        |
| 7  | 深圳市景旺电子股份有限公司  | 153.08   | 内资厂商，A 股上市公司，主营产品为 PCB、FPC、MPCB，生产基地分布在深圳、珠海、河源、吉安和赣州       |
| 8  | 华通电脑股份有限公司     | 125.63   | 中国台资控股厂商，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在重庆、苏州、惠州     |
| 9  | 欣兴电子股份有限公司     | 124.06   | 中国台资控股厂商，相关情况见上表“2025 年全球前十大 PCB 厂商”，其大陆生产基地分布在苏州、昆山和深圳     |
| 10 | 建滔集团有限公司       | 122.00   | 中国港资控股厂商，主营单双面板、多层及 HDI 板                                   |
| 合计 |                | 1,944.80 |                                                             |

资料来源：CPCA

2、发行人的竞争优势

（1）产品优势

公司实施差异化竞争战略，专注于工业控制、汽车电子、通信设备等领域，上述领域对 PCB 使用寿命、可靠性的标准较高，在生产制造、工艺技术、批量生产、出货检查等细节方面的要求比较严苛。公司坚持高品质的生产流程管控，比如减少叠板数以保证钻孔粗糙度的一致性，增加孔内电镀铜厚和严格执行线路图形不修正，以满足严苛的信赖性检测标准。公司经过多年生产技术积累和市场口碑沉淀，成为工业控制、汽车电子等领域可靠的 PCB 供应商。

目前，公司 PCB 广泛应用于知名企业产品上，如横河电机(YOKOGAWA)的工业流量测量计；禾赛科技的激光雷达；古野电气（FURUNO）的船舶雷达导航仪；岛津（SHIMADZU）的医疗测试仪；山洋电气（SANYODENKI）、安川电机（YASKAWA）的伺服器等，得到了客户广泛认可；此外，公司产品在无人机、光模块、传感器、智能驾驶、服务器、医疗设备、交通等领域也有广泛应用。

## （2）客户资源优势

PCB 行业是按照客户的需求提供定制化产品，客户对 PCB 供应商的选择认证十分谨慎。客户结合自身产品需求，对 PCB 企业的产品质量、技术水平、生产规模、产品交期、环保认证等诸多因素进行考量，一般会对 PCB 企业设置 1-2 年的考察期进行全方位考核。对于考核通过的 PCB 企业将会列入客户的合格供应商目录，双方展开长期的合作。工业控制、汽车电子等领域的客户对 PCB 品质、寿命、高可靠性要求更为严苛，为保证 PCB 长期可靠性，PCB 供应商与客户之间具有较强的黏性，上述领域的客户更加不会轻易更换供应商。

公司以客户为中心，凭借良好的产品质量、长期稳定的生产能力以及快速响应的客户服务，与较多优质客户建立了长期稳定合作关系。公司收入主要来自于国内外上市公司及知名 EMS 企业，电子产品制造商知名客户包括世界 500 强松下（Panasonic）、日立（HITACHI）、住友集团（Sumitomo Group），欧姆龙（OMRON）、岛津（SHIMADZU）、基恩士（KEYENCE）、横河电机（YOKOGAWA），及山洋电气（SANYODENKI）、古野电气（FURUNO）、希克斯（SIIX）等知名日本上市公司，罗克韦尔（Rockwell Automation）、禾赛科技等美国上市公司，万特集团（VENTURE）等新加坡上市公司，禾川科技、美的集团等国内上市公司，全球排列靠前 EMS 客户加达利（KATOLEC）、三和盛

(UMC)、GPV 集团等。全球排名前列的 PCB 生产企业包括客户 B、S&H INCOTEC Electronic GmbH、中央铭板 (CMK)、兴电集团 (KYODEN)、京写 (KYOSHA) 等上市公司。全球知名贸易商客户包括艾佳普 (ICAPE)、丰田通商株式会社等知名上市公司。

### (3) 全链协同与“中国+1”双基地驱动优势

公司构建了“样板-小批量-大批量-PCBA”全链条能力，覆盖客户全生命周期需求。通过六期工厂的差异化定位，实现了从研发到量产的无缝衔接，公司的柔性生产能力匹配工业控制、汽车电子、通信设备等下游应用领域的定制化需求，PCBA 延伸服务进一步绑定客户，形成“PCB 设计+制造+贴装”价值链闭环，客户黏性进一步增强。

在逆全球化思潮涌动和供应链区域化重构的背景下，公司前瞻性在海外进行产能扩张的战略布局，泰国工厂的设立与顺利投产是公司从“中国制造”向“全球制造+本地化服务”的跨越。海内外产能协同与定位差异化，优化了全球资源调配，构建了“中国+1”双生产基地模式，有利于公司直接服务于国际化客户群，能够更好地满足客户对供应链地域多元化的要求，规避贸易摩擦和地缘政治波动风险，并提供更快捷的本地化交付与服务，国际化运营能力进一步升级，为公司进一步开拓东南亚和欧美市场奠定了产能和品牌基础。

公司全流程制造高效率、高壁垒客户网络、全球化产能弹性及技术前瞻布局深度融合，“PCB 设计+制造+贴装”价值链闭环和“中国+1”双生产基地模式，在当前 PCB 行业高端化、全球化趋势下，其“技术+服务+效率”多维优势支撑公司长期可持续发展与超额收益潜力。

### (4) 管理优势

公司拥有一支技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队，借鉴日本企业品质管理和精益生产的理念，采取“丰田看板”的生产模式，实施“阿米巴”经营管理模式，制定完善的企业管理制度、流程体系，具有较强的执行力。

公司每月召开全体员工大会，通报每月的生产经营状况，通过月度提案、月度员工恳谈会听取员工意见，让员工参与公司经营，增强员工归属感和凝聚力，保持团队的稳定性。公司设立直属于总经理的客户服务窗口，便于及时对

应客户的反馈意见并保证客户的反馈必在 24 小时内得到有效回应。

电路板制造工序多、工艺复杂，生产过程中的每一个环节都可能影响到产品质量，对生产过程中的工艺参数设置要求十分严格。公司严格推行“4M 变更管理规定”，对人员、生产设备、原材料、生产工艺的变更进行严格管控，以保证在稳定受控的条件下，持续生产符合要求的高品质产品。

公司重视自动化与智能化的投入，多个生产工序通过智能扫码实现了自动跟踪数据，并通过云端数据智能管理技术对生产车间的温湿度、气压、水电等数据进行自动采集，实现数据的实时监控，大大提高了生产效率及管理效率，降低了人力成本。

#### （5）质量优势

公司从人员、设备、物料、方法、环境等方面构筑了一套行业先进水平的质量控制方法和模式，打造了从原材料采购、过程控制、出货检查、信赖性检测、全方位服务的高稳定性 PCB 生产体系，确保持续、稳定、快速地生产符合客户需求的高品质产品。公司技术人员聚焦生产现场，从生产源头管控异常，以“产品零缺陷、客户零投诉”为目标，精益求精，重视细节，持续推动标准化作业，保证高品质产品的生产。公司严格遵照客户标准对核心工序全部检查，对公司主要客户每月提供其产品的品质状况资料。

同时，公司在与世界优秀客户长期深入合作过程中，在客户的持续指导和要求下，建立世界先进水平的质量管理体系。公司取得并实施了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量体系认证、UL 安全标准认证等。

公司秉承“以极度认真的全员品质意识”的品质方针，异常条件下生产的产品一律报废，同时严禁 PCB 返工返修，通过长期切实有效的质量管理，公司产品质量赢得了客户的高度认可，多次获得客户颁发的产品质量奖项，包括欧姆龙（OMRON）的集团质量体系认证、岛津（SHIMADZU）、山洋电气（SANYO DENKI）、安川电机（YASKAWA）等的优秀供应商奖，树立了良好的市场口碑，为市场开发提供了良好的品质支撑。

#### （6）人才优势

公司在多年的经营发展中，形成了较稳定、专业且具有丰富行业经验的管理团队。公司董事长刘天明先生毕业于日本东京大学，有着十多年的日资 PCB 企业工作和管理经验，公司核心员工多年在 PCB 企业从事生产、技术、销售、管理，对电路板生产制造及品质管理理念有着深刻理解，熟悉客户的工作流程和管理风格，能够与客户进行积极有效沟通。公司人员结构稳定，本地员工占 70%以上，为本地员工提供有竞争力的薪酬；公司还注重通过股权激励机制吸引人才，增加员工对公司的归属感，为持续稳定生产高品质的 PCB 提供保证。

#### （7）技术优势

公司紧跟国际先进技术的发展趋势，通过不断参与客户产品研发合作、收集和分析下游产品的变化信息，及时掌握客户需求的变化，并进行技术前期开发。

公司是国家高新技术企业，获得广东省企业技术中心、广东省高可靠性电路板设计与制造工程技术研究中心、肇庆市级企业技术中心、肇庆市高可靠性电路板设计与制造工程技术研究中心等荣誉称号，多项成果获得科技成果鉴定及电路板相关的知识产权。

经过研发团队长期自主研发，公司已经掌握多种生产工艺，包括高多层板、HDI 板、刚挠结合板、高频高速板、金属基板、厚铜板等产品的生产技术。通过这些技术的运用，公司可向工业控制、汽车电子、通信设备、交通、医疗器械等高可靠性要求的产品领域提供相应产品，满足不同客户的需求，增强了市场竞争力。

#### （8）企业文化优势

公司以“成就国际一流企业”为愿景，保持长期艰苦奋斗的作风，为客户、为社会创造价值。公司尊重员工，积极听取员工意见，培养员工经营者意识，充分调动员工积极性；持续为员工提供在职培训，全方位提升员工专业能力和素质水平，保证了产品质量的稳定。公司贯彻“以人为本”的理念，以“满足员工物质、精神幸福”为经营目的，为员工提供基本住房需求，并为员工解决子女当地的就学问题，以鼓励员工在公司长期发展。

同时，公司坚持“以客户为中心”的经营方针，重视客户的满意度，快速响

应客户需求，以“认真、高效、负责”为企业作风。公司积极与客户互动，新客户首次实地考察全员配合，公司首次接单后及时拜访客户，产品量产后定期向客户提供产品的品质状况资料，获得了客户的高度认可。公司通过企业文化建设，将文化精髓根植于员工内心，提高了企业的凝聚力，增强了员工的责任感与使命感，更好地为客户创造价值。

### 3、影响行业发展的有利和不利因素

#### （1）有利因素

##### ①产业政策支持

电子信息产业是我国重点发展的战略性支柱产业，印制电路板行业作为电子产品的基础产品，受到国家政策的大力支持。我国先后通过出台《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《“十四五”数字经济发展规划》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等政策方针，把 PCB 行业相关产品列为重点发展对象。“十四五规划”中提出要加快壮大新一代信息技术、新能源汽车等产业，“十五五规划”提出全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。国务院及相关部委推出了“基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）”“5G 应用‘扬帆’行动计划（2021-2023 年）”“新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）”“工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）”等一系列产业政策支持和引导 5G 通信、新能源汽车、物联网、工业互联网等领域的发展。国家政策的扶持将为电子信息产业提供广阔的发展空间，推动了 PCB 行业的发展，助力电子制造业全面转型升级，国内 PCB 行业将借此契机不断提升企业竞争力。

##### ②下游应用领域的不断发展

印制电路板的下游行业广泛，包括工业控制、汽车电子、通讯设备、消费电子、军事航空、医疗器械等。广泛的应用分布为印制电路板行业提供巨大的市场空间，降低了行业发展的风险。随着 5G、云计算、大数据等技术的发展，对数据存储和计算力的需求呈高增长态势，服务器行业发展空间广阔。随着新能源汽车普及和汽车智能化程度加深，汽车电子行业对 PCB 的需求快速增长，

如电池管理系统（BMS）、智能座舱、自动驾驶传感器等，对 PCB 的可靠性、耐高温性和信号完整性要求极高，推动了车用 PCB 技术升级和价值量提升。通信电子（尤其是 5G 基站建设、光模块）和消费电子（如智能手机、可穿戴设备）一直是 PCB 需求的基本盘，其市场规模庞大，需求稳定，随着技术的持续创新，也在不断创造新的市场机会。PCB 应用行业的技术革新以及新兴产业的发展为 PCB 行业带来新机遇，为 PCB 市场发展提供了重要保障。

### ③中国电子行业产业链完整

近年来，中国电子信息产业一直保持快速发展，带动了中国电子信息产业链的发展。目前，中国电子信息产业链已日趋完整，国内电子行业规模大、配套能力强，产业集聚效应明显。中国印制电路板行业上游行业发展迅速，主要原材料如覆铜板、半固化片、铜箔等厂商具备充分生产供应能力，能快速响应 PCB 企业的需求。且在高端原材料领域，国内企业已实现突破，在高速覆铜板用的树脂方面，国内已有企业可提供 M6 至 M8（**M6 和 M8 指高频高速覆铜板，数字代表等级，等级越高，高频高速性能越好**）全系列产品，并进入主流供应链；在高端铜箔领域，国内厂商已具备 HVLP 1-4 代（**高端电解铜箔，拥有极低的表面粗糙度，满足 AI 大模型训练对超高算力和超快数据传输的需求，数字代表等级，数字越高，等级越高，性能越强**）的生产能力，并正向 HVLP 5（**高端电解铜箔 5 代，高频高速性能强**）技术攻关；在低介电常数玻纤布（Low-Dk 布）方面，国内龙头企业已实现量产并积极扩产，能满足高附加值、高技术难度产品的市场需求。

PCB 行业作为电子信息产业的基础行业，在产业链中起着承上启下的关键作用，完整的产业链使 PCB 企业既能快速采购原材料，又能快速响应客户需求，保障 PCB 产业稳定发展。

### ④全球产能继续向中国大陆等地区转移

近二十余年，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子信息产业产能向中国大陆、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移，PCB 行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自 2006 年以来，中国超越日本成为全球第一大 PCB

生产国，PCB 的产量和产值均居世界第一。以长三角和珠三角为代表的中国大陆电子信息产业规模大、产业链完整、配套能力强，产业集聚效应明显。目前，中国大陆 PCB 产品呈现量大但技术含量较低的特点，随着中国大陆 PCB 企业的不断发展，预计未来全球 PCB 产能尤其是中高端 PCB 产能向中国大陆转移的趋势仍将持续。

## （2）不利因素

### ①市场竞争加剧

全球 PCB 行业竞争格局较为分散，生产厂商众多，市场竞争较为充分，行业格局正朝着“大型化、集中化”方向发展，中小 PCB 企业面临更大生存压力。

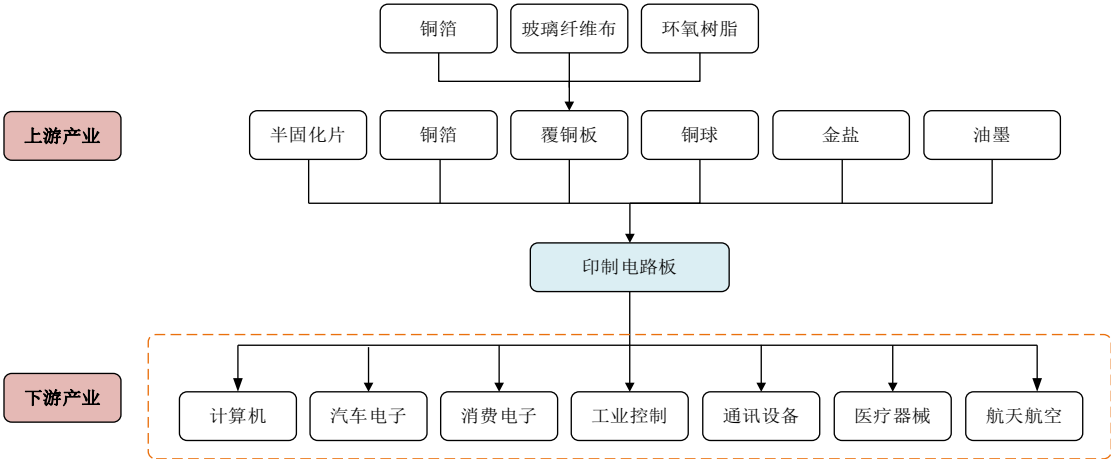
在 AI 终端、服务器、高速通信、智能汽车电子等新兴高端领域，由于对 PCB 的层数、材料、工艺提出了极高要求，技术壁垒和资金壁垒陡增，国内主流 PCB 厂商如深南电路、沪电股份、胜宏科技等正在增加资本开支，积极扩充高端产能，众多 PCB 厂商的加速切入，可能导致行业供给格局在未来趋于拥挤，未来 PCB 市场可能存在行业产能扩张规模过大导致竞争进一步加剧。

### ②劳动力和环保成本上涨

近年来，我国人口红利优势逐渐消失，劳动力供给日益紧张，我国劳动力成本逐渐上升，挤压 PCB 企业的利润空间。为缓解劳动成本上涨带来经营压力，部分企业逐步将生产基地转移至内陆地区。同时，严格的环保政策对 PCB 企业的成本管理和环保技术提出了新的要求。一方面环保要求的提升加大了企业新项目选址的难度；另一方面，环保成本的提高降低了项目的预期收益率。在双重成本压力的作用下，PCB 产业的落后产能将逐步被淘汰，未来几年行业的集中度将进一步提升。

## 4、上下游行业情况

PCB 行业上游为生产所需的原材料，主要包括覆铜板、半固化片、铜球、铜箔、金盐、油墨等。下游行业主要包括通讯、计算机、消费电子、汽车电子、服务器、工业控制、军事航空、医疗等领域。印制电路板行业上下游联系紧密，上下游的关系如下图所示：



(1) 上游行业对 PCB 行业的影响

从行业整体水平来看，原材料成本占 PCB 生产成本的一半以上，上游原材料的供应情况和价格水平对 PCB 企业的生产成本产生重大影响。我国 PCB 的上游配套产业发展成熟，供应充足且竞争较为充分，能够满足 PCB 行业的发展需求。

PCB 所使用的主要原材料中，覆铜板主要担负着 PCB 导电、绝缘、支撑三大功能，其性能直接决定 PCB 的性能，是生产 PCB 的关键基础材料，占直接材料成本比重最高。除了覆铜板以外，铜球和铜箔也是 PCB 生产的重要原材料。覆铜板、铜球和铜箔等原材料均是以铜作为基础材料，其价格受铜价影响较大。因此，铜价的变动会影响原材料的价格，并进一步影响 PCB 生产成本。

(2) 下游行业对 PCB 行业的影响

PCB 行业下游为各类电子信息产品，产品应用覆盖通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子、航空航天以及军事等领域。PCB 行业与下游行业已形成相互促进、共同发展的双赢关系。根据 Prismark 的统计和预测，2025 年，受益于 AI 服务器、人工智能、高速通信、数据/存储、算力设施、智能驾驶及相关高速网络基础设施推动等，全球 PCB 产值达到 858.36 亿美元，同比增长 16.7%。未来五年全球 PCB 市场将保持稳定增长，2025 年至 2030 年全球 PCB 产值的预计年复合增长率达 11.0%，至 2030 年预计全球 PCB 市场将达到 1,446.10 亿美元。

PCB 市场需求与电子信息产业整体发展情况具有较强的相关性。近年来随着全球科学技术飞速发展，5G、新能源汽车、Mini LED、人工智能等新的科技

热点不断涌现，带动全球电子信息产业持续增长，从而促进了 PCB 产业的发展。在科技热点的带动下，未来全球的电子信息产业仍将保持增长的势头，为 PCB 产业发展带来广阔的市场空间。与此同时，下游应用领域的技术发展会推动 PCB 产品的技术发展，以适应终端产品的市场需求。

四、发行人主营业务情况

（一）主要产品及其用途

1、公司的主营业务

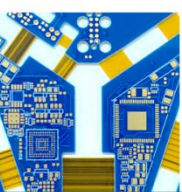
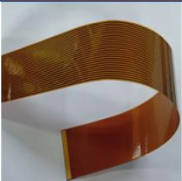
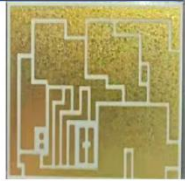
公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，公司专注于印制电路板中小批量板的制造，以“高品质、高可靠、短交期、快速响应”为市场定位，产品广泛应用于工业控制、汽车电子、消费电子、通信设备、医疗器械等领域。

自成立以来，公司的主营业务没有发生变化。

2、公司主要产品及其用途

印制电路板主要功能是使各种电子元器件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件。电子产品的可靠性很大程度上要依赖印制电路板的制造品质，因此印制电路板被称作“电子产品之母”。

公司印制电路板产品类型丰富，除单/双面板、多层板以外，产品类型覆盖 HDI 板、厚铜板、高频高速板、柔性板、刚挠结合板、陶瓷基板等。

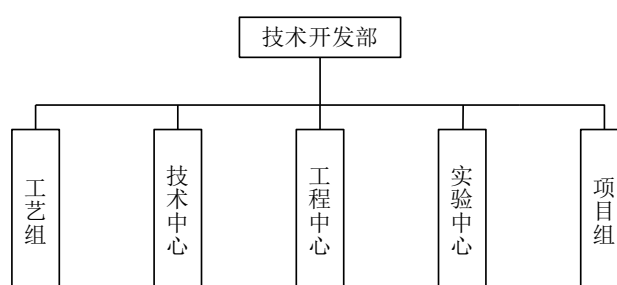
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HDI 板（高密度互连板）：</b>通过微盲/埋孔、细线（<math>\leq 3/3\text{ mil}</math>）及薄介质实现高密度布线，典型结构为任意层互连，用于激光雷达、传感器、服务器、光模块等。</p> |  <p><b>厚铜板：</b>外层铜厚 <math>\geq 2\text{ oz}</math>（<math>70\text{ }\mu\text{m}</math>），内层可达 <math>10\text{ oz}</math> 以上。具备强载流与散热能力，用于电源模块、大功率逆变器及工业控制器。</p> |  <p><b>高频高速板：</b>使用低介电常数（<math>Dk \leq 3.5</math>）与低损耗因子（<math>Df \leq 0.004</math>）的树脂体系（碳氢、PTFE），确保信号完整性。用于 5G 通信、毫米波雷达及高速光模块。</p> |  <p><b>柔性板（FPC）：</b>采用聚酰亚胺等柔性绝缘层，可弯折、卷曲。实现三维组装与动态挠性，用于折叠屏手机、摄像头模组及可穿戴设备。</p> |  <p><b>刚挠结合板：</b>将刚性 FR-4 与柔性 PI 区域一体化层压，通过互连孔直接导通。兼具支撑与弯折功能，用于卫星天线、汽车雷达及医疗内窥镜。</p> |  <p><b>陶瓷基板：</b>以氧化铝、氮化铝等陶瓷为基材，热导率高（<math>170\sim 230\text{ W/(m}\cdot\text{K)}</math>）、热膨胀系数匹配芯片。应用于 LED 照明、激光器及功率模块。</p> |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                            |

## （二）主要经营模式

### 1、研发模式

#### （1）研发体系

在研发创新方面，公司设立了技术开发部，建立了完善的研发体系，进行新产品、新技术、新工艺、新材料的开发研制，提升生产效率，不断优化产品结构 with 功能。公司研发部的具体组织结构如下图所示：

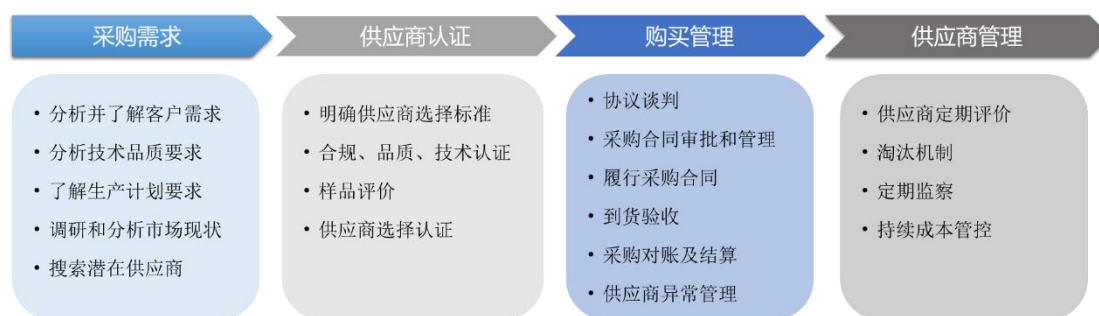


工艺组主要负责对公司的订单进行技术审核，评判公司的技术水平能否满足订单要求，并对具体的技术要点、工艺流程进行设计把控。技术中心主要负责对新产品以及政府鼓励的相关项目进行开发。实验中心负责根据产品详细设计说明，对制作的样品进行试制和样品试验。另外，公司的技术开发部门职责还包括对公司的生产安全和环境保护进行监查。

公司通过新项目的研发及时响应客户需求，提前布局未来的产品与技术，参与客户下一代产品的开发与设计，为客户提供无缝衔接的全方位综合性的产品和服务，与客户形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。

### 2、采购模式

公司根据生产计划安排采购计划，主要原材料的采购根据公司现有订单需求及营业部的预计订单进行采购，辅料则是每月按照预计使用量进行采购。公司购入的主要原材料包括覆铜板、金盐、铜箔、铜球、半固化片、干膜等，辅料包括化学药品、焊锡、钻头、铣刀等。在供应商选择时，公司会对供应商进行资质审查，对其经营资质、生产和技术能力、产品质量、供货及时性、服务质量、环境保护等方面进行综合考量，经审核后，将符合要求的供应商列入合格供应商名录。公司采购的流程如下图所示：



### 3、生产模式

公司产品为定制化产品，因此公司根据客户订单生产，采取“丰田看板”的生产模式，并实行柔性化的生产管理。制造技术部下设的生产计划课根据订单的要求制定生产计划，制造技术部按照生产计划组织生产。具体生产管理作业流程如下：

（1）营业部接到客户订单时，首先进行订单评审。如涉及新产品，则由产品评审部负责公司新产品的开发及样品生产；

（2）生产计划部根据订单计划、产能情况制定生产投入计划。若公司的某工序产能无法满足生产投入计划，就会通过《合格供应商名录》寻找外协加工厂商进行委外加工；

（3）制造技术部依据每日生产报表，管理订单的生产进度状况，发现有延误及需要调整进度的批量时，及时指示调整，在加工过程中，紧急批量优先普通批量加工。

在生产过程中，公司采取全员检查的方式，每道工序的作业员都对产品质量进行在线检查，同时品质保证部的人员也会对产成品的外观、品质进行检测，产品出货前会进行热冲击抽检试验，检验合格后交付给客户。

### 4、销售模式

公司产品有“小批量、多品种”的特点，以日系客户为主，国内和欧美客户为辅。公司下游应用领域以工业控制为主，上述客户相对价格而言更看重产品的品质、交期、沟通、售后服务等。

公司设立了营业部，负责新客户拓展及老客户服务，接待客户到厂审查，并通过参加各地主要电子产品展会的方式拓展新客户。营业部具有完整的销售

业务体系，充分以客户为中心，满足客户需求，根据销售地区进行分组，分别负责日本、欧美及国内市场；营业部配有专门的销售服务人员，主要负责报关、出货、订单管理以及货款回收等工作。

### （三）营业收入情况

#### 1、营业收入的构成情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2026 年 1-6 月 |         | 2025 年     |         | 2024 年     |         | 2023 年     |         |
|------|--------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|      | 金额           | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      |
| 主营业务 | 116,206.52   | 94.28%  | 183,139.76 | 94.81%  | 134,600.90 | 95.25%  | 126,981.26 | 96.59%  |
| 其他业务 | 7,055.81     | 5.72%   | 10,033.26  | 5.19%   | 6,716.88   | 4.75%   | 4,487.88   | 3.41%   |
| 合计   | 123,262.33   | 100.00% | 193,173.02 | 100.00% | 141,317.77 | 100.00% | 131,469.14 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务收入金额分别为 126,981.26 万元、134,600.90 万元、183,139.76 万元和 **116,206.52 万元**。公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 96.59%、95.25%、94.81%和 **94.28%**，均在 94%以上，公司主营业务突出。

#### 2、主营业务收入构成情况

报告期，公司按产品类型划分的主营业务收入结构情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2026 年 1-6 月 |         | 2025 年     |         | 2024 年     |         | 2023 年     |         |
|-------|--------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|       | 金额           | 比例      | 金额         | 比例      | 金额         | 比例      | 金额         | 比例      |
| 双面板   | 24,874.69    | 21.41%  | 45,463.87  | 24.82%  | 36,247.41  | 26.93%  | 37,266.87  | 29.35%  |
| 多层板   | 76,002.67    | 65.40%  | 114,980.08 | 62.78%  | 82,023.56  | 60.94%  | 77,279.19  | 60.86%  |
| HDI 板 | 15,329.16    | 13.19%  | 22,695.82  | 12.39%  | 16,329.92  | 12.13%  | 12,435.20  | 9.79%   |
| 合计    | 116,206.52   | 100.00% | 183,139.76 | 100.00% | 134,600.90 | 100.00% | 126,981.26 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务收入呈不断上升趋势，其中多层板和 HDI 占主营业务收入比重分别为 70.65%、73.07%、75.18%和 **78.59%**，多层板和 HDI 板的收入占比逐年提升，产品结构持续优化。

**（四）主要产销量情况**

报告期内，公司产品的产能、产量和销量情况如下：

单位：万平方米

| 项目  |       | 2026 年 1-6 月 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|-----|-------|--------------|--------|--------|--------|
| PCB | 产能    | 96.78        | 177.07 | 146.05 | 131.49 |
|     | 自产产量  | 89.81        | 156.15 | 125.34 | 116.75 |
|     | 销量    | 87.49        | 151.30 | 122.74 | 115.10 |
|     | 产能利用率 | 92.79%       | 88.19% | 85.82% | 88.79% |
|     | 产销率   | 97.42%       | 96.89% | 97.93% | 98.59% |

注：产能利用率=自产产量/产能；产销率=销量/自产产量。

报告期内，公司的产能、产量、销量均逐年增长，总体上公司的产能利用率始终保持在较高的水平。

报告期内，公司的产销率较高，主要系公司采取“以销定产”的生产模式，根据客户的订单来组织生产，产品产销率均处于较高水平。

**（五）主要原材料采购及能源供应情况**

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜及油墨等，公司产品所用原材料种类及型号较多，上游行业技术较为稳定、产品较为成熟、供应量充足、市场充分竞争，主要供应商与公司长期合作，供货及时。

公司产品生产过程中使用的能源主要是电力，采购自当地供电公司，供应稳定、充足，能源占生产成本的比例相对较小。报告期内，公司生产电力耗用的情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2026 年 1-6 月 | 2025 年   | 2024 年   | 2023 年   |
|------|--------------|----------|----------|----------|
| 电力耗用 | 5,186.72     | 8,787.96 | 6,671.43 | 6,674.35 |

2024 年，发行人生产电力耗用金额略微下降，主要系上游煤炭价格的持续下行和广东省市场供应电力增加，单位电费市场价格下降。

**（六）与业务相关的主要固定资产和无形资产**

**1、固定资产基本情况**

公司的固定资产主要包括：房屋建筑物、机器设备、运输设备等。截至

2026 年 6 月 30 日，公司固定资产原值为 148,656.03 万元，账面价值为 97,286.48 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 类别      | 原值         | 累计折旧      | 账面价值      | 成新率    |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|
| 房屋及建筑物  | 33,216.48  | 6,479.72  | 26,736.75 | 80.49% |
| 机器设备    | 113,200.16 | 43,259.15 | 69,941.00 | 61.79% |
| 运输设备    | 648.98     | 428.14    | 220.84    | 34.03% |
| 电子设备及其他 | 1,590.42   | 1,202.54  | 387.88    | 24.39% |
| 合计      | 148,656.03 | 51,369.56 | 97,286.48 | 65.44% |

## 2、无形资产基本情况

发行人无形资产主要包括土地使用权、境外土地所有权、软件，报告期末公司无形资产情况如下表所示：

单位：万元

| 项目      | 期末余额      | 累计摊销     | 账面价值      |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 土地使用权   | 8,228.83  | 1,088.58 | 7,140.25  |
| 境外土地所有权 | 4,882.10  | -        | 4,882.10  |
| 软件      | 1,014.19  | 534.71   | 479.48    |
| 合计      | 14,125.11 | 1,623.29 | 12,501.82 |

注：公司泰国子公司一品电路在泰国购买土地，拥有土地永久产权，未进行摊销。

## 3、土地使用权及房产情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其下属子公司拥有的土地使用权及房产情况如下表所示：

### （1）土地使用权情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其下属子公司拥有的土地使用权情况如下：

| 序号 | 权利人  | 地块位置              | 证书编号                      | 面积（m <sup>2</sup> ） | 使用期限                | 取得方式 |
|----|------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------|
| 1  | 四会富仕 | 四会市下茆镇四会电子产业园 2 号 | 粤（2018）四会市不动产权第 0016232 号 | 27,398.54           | 2013.1.8 至 2063.1.7 | 出让   |
|    |      |                   | 粤（2018）四会市不动产权第 0016233 号 |                     |                     |      |
|    |      |                   | 粤（2018）四会市不动产权第 0016234 号 |                     |                     |      |
|    |      |                   | 粤（2019）四会市不动产权第 0008400 号 |                     |                     |      |
|    |      |                   | 粤（2019）四会市不动产权第 0008401 号 |                     |                     |      |

|   |      |                             |                           |           |                         |    |
|---|------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----|
|   |      |                             | 粤（2019）四会市不动产权第 0008402 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2019）四会市不动产权第 0008403 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2019）四会市不动产权第 0008404 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2019）四会市不动产权第 0008405 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2019）四会市不动产权第 0008406 号 |           |                         |    |
| 2 | 四会富仕 | 四会市下茆镇四会电子产业园 3 号           | 粤（2021）四会市不动产权第 0001644 号 | 15,388.12 | 2014.11.25 至 2064.11.24 | 出让 |
|   |      |                             | 粤（2021）四会市不动产权第 0001648 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2021）四会市不动产权第 0001651 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2021）四会市不动产权第 0001652 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2021）四会市不动产权第 0024013 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2021）四会市不动产权第 0024036 号 |           |                         |    |
| 3 | 四会富仕 | 四会市下茆镇四会电子产业园 4 号           | 粤（2022）四会市不动产权第 0023285 号 | 19,496.18 | 2020.12.30 至 2070.12.29 | 出让 |
|   |      |                             | 粤（2022）四会市不动产权第 0023287 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2022）四会市不动产权第 0023805 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2026）四会市不动产权第 0009058 号 |           |                         |    |
| 4 | 四会富仕 | 四会市龙甫镇惠源三路 1 号              | 粤（2026）四会市不动产权第 0008316 号 | 87,607.54 | 2021.1.28 至 2071.1.27   | 出让 |
|   |      |                             | 粤（2026）四会市不动产权第 0008304 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2026）四会市不动产权第 0008336 号 |           |                         |    |
|   |      |                             | 粤（2026）四会市不动产权第 0008321 号 |           |                         |    |
| 5 | 一品电路 | 7/44 第 4 村，帕那尼空镇，尼孔帕塔纳县，罗勇府 | 100576、81277              | 88,598.00 | 永久（土地使用权）               | 受让 |
|   |      | 7/51 第 4 村，帕那尼空镇，尼孔帕塔纳县，罗勇府 | 48747、48748、48749         | 4,800.00  | 永久（土地使用权）               | 受让 |

## （2）房屋建筑物情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其下属子公司已取得的房屋的所有权具体情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 不动产权证号 | 房屋坐落位置 | 建筑面积 | 房屋用 | 取得 |
|----|------|--------|--------|------|-----|----|
|----|------|--------|--------|------|-----|----|

|    |      |                           |                   | (m <sup>2</sup> ) | 途     | 方式 |
|----|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 1  | 四会富仕 | 粤(2018)四会市不动产权第 0016232 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 2 号 | 8,210.80          | 厂房    | 自建 |
| 2  | 四会富仕 | 粤(2018)四会市不动产权第 0016234 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 2 号 | 12,226.32         | 厂房    | 自建 |
| 3  | 四会富仕 | 粤(2018)四会市不动产权第 0016233 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 2 号 | 1,962.36          | 仓库    | 自建 |
| 4  | 四会富仕 | 粤(2019)四会市不动产权第 0008400 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 2 号 | 404.64            | 厂房    | 自建 |
| 5  | 四会富仕 | 粤(2019)四会市不动产权第 0008401 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 2 号 | 13.34             | 附属设施  | 自建 |
| 6  | 四会富仕 | 粤(2019)四会市不动产权第 0008402 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 2 号 | 266.27            | 厂房    | 自建 |
| 7  | 四会富仕 | 粤(2019)四会市不动产权第 0008403 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 2 号 | 152.70            | 厂房    | 自建 |
| 8  | 四会富仕 | 粤(2019)四会市不动产权第 0008404 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 2 号 | 933.89            | 厂房    | 自建 |
| 9  | 四会富仕 | 粤(2019)四会市不动产权第 0008405 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 2 号 | 48.00             | 附属设施  | 自建 |
| 10 | 四会富仕 | 粤(2019)四会市不动产权第 0008406 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 2 号 | 175.92            | 厂房    | 自建 |
| 11 | 四会富仕 | 粤(2021)四会市不动产权第 0001644 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 3 号 | 98.45             | 附属设施  | 自建 |
| 12 | 四会富仕 | 粤(2021)四会市不动产权第 0001648 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 3 号 | 13,938.99         | 办公、宿舍 | 自建 |
| 13 | 四会富仕 | 粤(2021)四会市不动产权第 0001651 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 3 号 | 100.80            | 附属设施  | 自建 |
| 14 | 四会富仕 | 粤(2021)四会市不动产权第 0001652 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 3 号 | 21.45             | 附属设施  | 自建 |
| 15 | 四会富仕 | 粤(2021)四会市不动产权第 0024013 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 3 号 | 26,208.00         | 厂房    | 自建 |
| 16 | 四会富仕 | 粤(2021)四会市不动产权第 0024036 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 3 号 | 480.24            | 附属设施  | 自建 |
| 17 | 四会富仕 | 粤(2022)四会市不动产权第 0023285 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 4 号 | 8,400.00          | 厂房    | 自建 |
| 18 | 四会富仕 | 粤(2022)四会市不动产权第 0023287 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 4 号 | 827.67            | 附属设施  | 自建 |
| 19 | 四会富仕 | 粤(2022)四会市不动产权第 0023805 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 4 号 | 220.80            | 附属用房  | 自建 |
| 20 | 四会富仕 | 粤(2026)四会市不动产权第 0009058 号 | 四会市下茆镇四会电子产业园 4 号 | 26,000            | 厂房    | 自建 |
| 21 | 四会富仕 | 粤(2026)四会市不动产权第 0008316 号 | 四会市龙甫镇惠源三路 1 号    | 2,977.54          | 办公    | 自建 |
| 22 | 四会富仕 | 粤(2026)四会市不动产权第 0008304 号 | 四会市龙甫镇惠源三路 1 号    | 1,770.62          | 宿舍    | 自建 |
| 23 | 四会富仕 | 粤(2026)四会市不动产权第 0008336 号 | 四会市龙甫镇惠源三路 1 号    | 1,765.10          | 宿舍    | 自建 |
| 24 | 四会富仕 | 粤(2026)四会市不动              | 四会市龙甫镇惠源三         | 916.26            | 附属设   | 自建 |

|    |      | 产权第 0008321 号     | 路 1 号                       |           | 施       |    |
|----|------|-------------------|-----------------------------|-----------|---------|----|
| 25 | 一品电路 | 100576、81277      | 7/44 第 4 村，帕那尼空镇，尼空帕塔纳县，罗勇府 | 24,336.74 | 厂房      | 自建 |
| 26 | 一品电路 |                   |                             | 1,039.80  | 废水站     | 自建 |
| 27 | 一品电路 |                   |                             | 501.00    | 门卫室     | 自建 |
| 28 | 一品电路 |                   |                             | 3,680     | 仓库      | 自建 |
| 29 | 一品电路 |                   |                             | 396.34    | 仓库      | 自建 |
| 30 | 一品电路 |                   |                             | 456.00    | 仓库      | 自建 |
| 31 | 一品电路 |                   |                             | 1,440.00  | 食堂      | 自建 |
| 32 | 一品电路 | 48747、48748、48749 | 7/51 第 4 村，帕那尼空镇，尼空帕塔纳县，罗勇府 | 805.00    | 消防水池与泵房 | 自建 |
| 33 | 一品电路 |                   |                             | 1,111.20  | 宿舍楼     | 自建 |

4、专利情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有专利权 30 项，其中 19 项为发明专利、11 项为实用新型专利，专利的具体情况如下：

| 序号 | 专利名称                      | 专利号               | 专利类型 | 授权公告日      | 期限   | 专利权人 | 取得方式 |
|----|---------------------------|-------------------|------|------------|------|------|------|
| 1  | 一种化学铜废液和棕化废液协同处理的方法       | ZL202310866959.2  | 发明专利 | 2025-10-28 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 2  | 一种金属基 FR4 混压基板及其生产方法      | ZL202110593490.0  | 发明专利 | 2025-07-01 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 3  | 一种替代积层胶膜的方法               | ZL202210770649.6  | 发明专利 | 2024-10-01 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 4  | 一种选择性化学镀厚金的方法             | ZL202111006379.3  | 发明专利 | 2024-07-09 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 5  | 一种酸性含铜液循环回收利用并制备氧化铜纳米线的方法 | ZL202210523614.2  | 发明专利 | 2024-05-14 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 6  | 一种提高光面铜结合力的方法             | ZL202110882720.5  | 发明专利 | 2024-05-07 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 7  | 一种金属填通孔的方法                | ZL202210470464.3  | 发明专利 | 2023-11-10 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 8  | 一种激光辅助制作精密线路的方法           | ZL202111465495.1  | 发明专利 | 2023-10-24 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 9  | 一种可分离电镀铜层的方法              | ZL202011449382.8  | 发明专利 | 2023-08-18 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 10 | 一种改善电镀铜层剥离不净的方法           | ZL202011447156.6  | 发明专利 | 2023-08-08 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 11 | 一种陶瓷基板的制作方法               | ZL202110243864.6  | 发明专利 | 2023-07-21 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 12 | 一种铜基板电镀铜的方法               | ZL202210100949.3  | 发明专利 | 2023-05-05 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |
| 13 | 一种用石墨烯对陶瓷表面粗化的方法及覆铜板的制作方法 | ZL2020115452331.1 | 发明专利 | 2023-01-06 | 20 年 | 四会富仕 | 申请取得 |

|    |                          |                      |      |            |      |          |          |
|----|--------------------------|----------------------|------|------------|------|----------|----------|
| 14 | 一种精密线路的制作方法<br>及电路板      | ZL2021102<br>91328.3 | 发明授权 | 2022-11-18 | 20 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 15 | 一种层间交叉线连接结构<br>的制作方法及电路板 | ZL2021104<br>58691.X | 发明授权 | 2022-07-22 | 20 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 16 | 一种无机微滤膜的制造方<br>法         | ZL2018101<br>19745.8 | 发明授权 | 2022-05-17 | 20 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 17 | 一种 PCB 动态导通可靠性<br>测试方法   | ZL2019104<br>93960.9 | 发明授权 | 2022-04-01 | 20 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 18 | 一种 PCB 超厚铜板的字<br>符加工方法   | ZL2019110<br>77102.2 | 发明授权 | 2021-03-05 | 20 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 19 | 一种高散热的金属基板的<br>制作方法      | ZL2019114<br>03538.6 | 发明授权 | 2020-12-11 | 20 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 20 | 一种金属基 FR4 混压基板           | ZL2021211<br>87457.X | 实用新型 | 2021-11-19 | 10 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 21 | 一种 PCB 基板                | ZL2021211<br>75543.9 | 实用新型 | 2021-11-19 | 10 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 22 | 一种金属基软硬结合板               | ZL2021211<br>73181.X | 实用新型 | 2021-11-19 | 10 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 23 | 一种新型铜基镜面铝复合<br>基板        | ZL2020205<br>96708.9 | 实用新型 | 2020-10-16 | 10 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 24 | 一种嵌铜盲埋孔基板                | ZL2020205<br>96747.9 | 实用新型 | 2020-10-16 | 10 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 25 | 一种带有保护围墙的基板              | ZL2020205<br>96028.7 | 实用新型 | 2020-10-16 | 10 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 26 | 一种高散热的夹心金属基<br>板         | ZL2019224<br>91476.0 | 实用新型 | 2020-08-11 | 10 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 27 | 一种可弯折基板                  | ZL2019224<br>64758.1 | 实用新型 | 2020-08-11 | 10 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 28 | 一种高散热的单面金属基<br>板         | ZL2019224<br>93364.9 | 实用新型 | 2020-08-11 | 10 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 29 | 一种双面凸台基板                 | ZL2019224<br>26252.1 | 实用新型 | 2020-08-11 | 10 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |
| 30 | 一种可嵌入元器件的凹槽<br>基板        | ZL2019223<br>88129.5 | 实用新型 | 2020-08-07 | 10 年 | 四会<br>富仕 | 申请<br>取得 |

### （七）业务经营资质

截至本募集说明书签署日，根据企业信用报告（无违法违规证明版）、境外律师出具的《境外法律意见书》、企业出具的说明及经保荐机构核查，发行人及其子公司已经取得与其生产及经营相关的必要资质，报告期内其生产及经营符合其注册地和经营地的法律和监管要求，不存在重大违法违规行为。其业务范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定；

### （八）核心技术来源

公司主要产品的核心技术及其来源如下：

| 序号 | 核心技术名称          | 技术来源 | 技术先进性及其特征                                                                                                                                  |
|----|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 高多层高密度 HDI 互联技术 | 自主研发 | 应用于高端消费电子、服务器、AI 终端等高多层 HDI 产品。采用多阶盲孔互联、LDI 高精度对位、预补偿涨缩控制、盲孔填孔电镀等工艺，实现 5 阶及以上盲孔叠孔对位精度≤2mil，盲孔真圆度≥90%，孔径公差±0.3mil 内；支持线宽/线距≤1.8/1.8mil 精细化线 |

|    |                           |      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |      | 路，提升布线密度与产品可靠性，适配小型化、高密度集成需求。                                                                                                                                                                                   |
| 2  | 高多层背钻工艺技术                 | 自主研发 | 应用于高多层服务器、光模块、高速通讯 PCB。采用 CCD 光学图形对位、精准深度控制、残桩管控技术，BGA 区域对位精度 $\leq 1\text{mil}$ ，层间对位 $\leq 2\text{mil}$ ，背钻残桩 Stub $\leq 3\text{mil}$ ；降低高速信号串扰与损耗，支持 16G 及以上单通道传输速率，保障信号完整性。                                 |
| 3  | 24~80 层 ATE 测试板技术         | 自主研发 | 应用于半导体 ATE 功能测试板、芯片测试载板。通过精确控制膨胀系数，实现精准的层间对位，以及分步钻孔方法，达成良好的 6mm 板厚 via 孔钻孔质量，以及脉冲电镀的高厚径比的深镀能力等工艺，实现 24~80 层超多层 PCB 稳定量产，板厚均匀性 $\pm 7\%$ 内，层间对位 $\leq 2\text{mil}$ ；高精度阻抗控制、低信号损耗、高结构稳定性，满足半导体测试设备高速、高频、高可靠测试需求。 |
| 4  | 高频材料+FR4 混压技术             | 自主研发 | 应用于高频通讯、雷达、服务器 PCB。实现 PTFE/碳氢/PI 等高频材料与 FR4 常规板材稳定压合，控制介电常数均匀性、层间粘接力与尺寸稳定性，兼顾高频低损耗与低成本、高工艺兼容性，支持高频高速信号传输。                                                                                                       |
| 5  | 高频 77G 雷达 PCB 技术          | 自主研发 | 应用于车载 77G 毫米波雷达、安防雷达 PCB。采用低 Dk/Df 高频基材、精细线路、低损耗阻抗控制、低信号插损设计，满足毫米波段低损耗、高抗干扰、高一致性要求，保障雷达探测精度与稳定性。                                                                                                                |
| 6  | 高多层通孔互联技术                 | 自主研发 | 应用于超高多层板制造、服务器 PCB。选用可靠性远高于盲孔的通孔互连，规避电镀缺陷，结合内层设计实现充裕布线空间与稳定阻抗控制，通过缩短信号路径、减少过孔等设计，大幅降低信号损耗与反射。从内层线路避让、外层焊盘 POFV 工艺，到全通孔真空树脂塞孔、PP 层隔离设计，全方位保障可制造性与互连可靠性，工艺端打造标准化制程，经内层制作压合、钻孔刻蚀隔离、化学沉铜电镀等步骤，实现层间稳定电气隔离。           |
| 7  | 高阶 HDI 基板的制作工艺研究与开发       | 自主研发 | 应用于高端 HDI、类载板、IC 封装载板。突破多阶盲孔、精细线路、高可靠填孔、高精度对位等关键工艺，支持线宽/线距 $\leq 25/35\mu\text{m}$ ，盲孔填平 Dimple $\leq 10\mu\text{m}$ ；提升良率与生产效率，适配高端芯片封装与高密度终端。                                                                 |
| 8  | 新能源电动车电源基板的制作工艺研究与开发      | 自主研发 | 应用于新能源汽车电源、电控、OBC、BMS 基板。高导热、高耐压、大电流承载、耐高温高湿，采用埋嵌铜/厚铜工艺，提升散热与载流能力，满足车规 AEC-Q 可靠性要求。                                                                                                                             |
| 9  | Anylayer HDI 基板的制作工艺研究与开发 | 自主研发 | 应用于高端手机、AIoT、穿戴设备 Anylayer HDI。任意层间盲孔直接互联，无需阶梯叠孔，设计灵活、层数利用率高、板厚更薄，高精度对位与填孔，通过红外热熔，及优化层压升温速率等工艺改良，叠加数字化层间膨胀系数的设计能力升级脉冲电镀，可提升任意层互联 HDI 的良率水平。                                                                     |
| 10 | 50 层以上基板的制作工艺研究与开发        | 自主研发 | 应用于超高层服务器、AI 加速卡、ATE 测试基板。通过改善层间介质厚度的均匀性与层压升温速率，严控板厚均匀性，并通过分步钻孔的方式，提升高多层高厚径比板的机械钻孔能力，从而实现 50 层以上超多层 PCB 稳定量产，满足超大电流、高速信号、高结构强度产品对高多层板的需求。                                                                       |
| 11 | PTFE 高频高速基板的制作工艺研究与开发     | 自主研发 | 应用于射频、微波、毫米波、卫星通讯 PCB。攻克 PTFE 难粘、易涨缩、易变形等工艺难点，实现高精度压合、线路、钻孔与阻抗控制；低插损、高一致性、高频稳定传输。                                                                                                                               |
| 12 | Tenting 工艺 1.6T 光模块板制造技术  | 自主研发 | 应用于高速光模块 PCB。采用 Tenting 工艺优化阻焊与线路保护，严控阻抗公差 $\pm 5\%$ ，背钻残桩 $< 3\text{mil}$ ，铜厚均匀性 $\geq 95\%$ ，满足 1.6T 超高速低损耗、低串扰、高可靠性要求。                                                                                       |
| 13 | RCC 工艺 800G 光模块板制造技术      | 自主研发 | 应用于高速光模块 PCB。采用 RCC 涂胶铜箔工艺，减薄介质层、提升布线密度与高频性能，通过高精度压合、阻抗、背钻与蚀刻管控，满足 800G 高速信号低损耗、高一致性量产。                                                                                                                         |
| 14 | AI 加速卡高频混压 PCB 制造技术       | 自主研发 | 应用于 AI 训练/推理加速卡、GPU 载板。通过高频材料+FR4 混压，实现信号层、电源层不同材料同时加工，降低成本，提升效率，通过层压、钻孔、电镀等工艺的优化，实现高频高速、高密度 HDI 的量产化，以适配高频通信与阻抗控制的产品。                                                                                          |
| 15 | 高多层不对称结构背钻服务器基板制造技术       | 自主研发 | 应用于高端服务器不对称结构基板。通过优化压合工艺，提升板面均匀性，再以高精度背钻工艺，对残桩进行钻除，以实现高速信号传输的稳定性，保障高速信号低损耗、高稳定传输。                                                                                                                               |
| 16 | 封装载板的制造技术                 | 自主研发 | 应用于 800G/1.6T 高速光模块载板、存储封装载板。通过药液分区附着、分步微蚀，啃蚀树脂剥离内嵌残铜，大幅压低线路侧蚀。可稳定制作超细线路，不用高价等离子设备，提升 IC 载板可靠性与量产良率，构筑国产高端封装基板工艺壁垒。                                                                                             |
| 17 | PI 覆铜膜的制造技术               | 自主研发 | 应用于低成本无 ABF 载板工艺；摒弃高价进口 ABF 材料，无玻纤结构减少线路蚀刻缺陷与载板翘曲；离子束孔壁镀铜提升盲孔导电可靠性，适配超细线路高速封装，大幅降低                                                                                                                              |

|    |                       |      |                                                                                                  |
|----|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |      | 原料成本，实现高端 IC 载板国产工艺替代。                                                                           |
| 18 | 传输信号且导热的多层玻璃基板工艺研究与开发 | 自主研发 | 应用于 AI 大算力芯片。全通孔厚铜+导热树脂构成垂直导热阵列，散热优于嵌陶瓷方案。一体钻孔分步电镀替代多层盲孔工艺，无应力与对位误差累积，兼容有机、陶瓷基材，兼顾超高速信号传输与高功率散热。 |

## 五、现有业务发展安排及未来发展战略

### （一）公司发展战略

公司将继续聚焦 PCB 制造，深耕以工业控制和汽车电子领域为代表的高品质 PCB 领域的同时，紧跟行业发展趋势，推进研发创新，全面布局产品矩阵，提升服务器板、光模块板等高附加值产品的比例，奠定公司在高品质 PCB 细分领域的领先地位，满足客户多品类采购需求。

在聚焦 PCB 制造的同时，公司将向产业链上下游延伸，为客户提供“PCB 方案设计+PCB（小、中、大批量制造）+PCBA”的全流程服务，满足客户一站式采购需求。

### （二）公司发展规划

#### 1、积极实施募集资金投资项目

目前，中国的印制电路板产值居于全球第一，拥有良好的市场前景。随着下游应用领域市场需求的快速增长，公司批量生产高端产品的产能瓶颈凸显，制约了公司业务的进一步发展。

通过本次募集资金投资项目，公司将形成 60 万平方米高多层、HDI 电路板生产能力，产品主要应用于工业控制、汽车电子、服务器、光模块等领域。公司高端产品生产能力的大幅提高可以更好地应对未来市场对 PCB 的需求，提高公司产品竞争力，把握下游市场快速发展的机遇。

#### 2、开拓细分领域市场，升级产品结构

报告期内，公司产品应用领域主要为工业控制、汽车电子、通信领域等。近年来，随着下游行业产品不断升级创新，对上游印制电路板产品要求不断提高。公司将积极开拓细分领域市场，重点拓展 AI 智能终端、新能源及智能驾驶汽车类、服务器、光模块等高成长市场领域，聚焦高技术、高附加值产品，以实现产品结构的升级创新，同时针对每个具有高成长性的细分市场加大开拓力

度，加强与客户的技术合作交流。

### 3、加强营运管理，强化品质稳定优势

#### （1）推进数字化运营，构建精益管理体系

公司将持续推进数字化、自动化与智能化三位一体的管理升级，强化以数据驱动的运营决策能力。通过优化信息管理系统，提升信息采集、流转与分析的及时性、精准性，实现管理流程的标准化与可视化。

同时，公司构建常态化的跨部门议事机制，在项目全生命周期中强化事前可行性评估、事中动态监控与事后绩效归因，推动全员信息化管理意识的落地，确保自动化与信息化工具从“系统上线”走向“管理闭环”，有效降低操作风险与信息不对称。

#### （2）深化产品质量体系建设

公司将持续夯实全链条品质保障体系，将产品质量管理置于战略优先级。在已取得 ISO 9001、ISO 14001 及 IATF 16949（汽车行业）等权威体系认证的基础上，进一步推动体系标准与业务实践的深度融合。

未来，公司将围绕来料质量控制、制程控制、成品检验及售后质量反馈四个关键环节，开展流程再造与能力提升，重点优化工艺参数管控、检测频次与异常追溯机制，最大化实现产品品质的一致性、可重复性与长期稳定性。通过降低不良率，持续巩固公司在下游客户供应链中的核心供应商地位，形成可量化的质量壁垒。

### 4、提升研发能力

公司实施“需求牵引+技术驱动”双轮研发战略，建立以终端客户技术路线图为导向的立项机制，确保研发投入精准匹配下游应用领域高景气赛道需求，同时引进和培养高端人才，加强公司新产品、新工艺和新材料的研发能力。

未来公司将引进行业的高级研发人才，构建多层级、跨学科的技术团队。购入先进试验设备，为研发中心的运行提供坚实的硬件基础与实验验证能力，形成“人才+设备+数据”三位一体的研发基础设施。同时，公司将与国内外知名研究机构、高等院校建立密切的合作关系，通过产学研结合的方式，提升产品

开发及技术研发能力，以满足公司发展的需要。此外，公司将制定详细的培训计划，加强技术团队培养，建立健全技术人员的晋升、激励机制，执行绩效考核机制，促进团队的健康发展。

公司的技术发展计划立足于产品战略的发展需要，未来，公司将继续以类载板、金属基板、陶瓷基板、刚挠结合板、任意层多层连接板的相关技术为研发重点，增加产品附加价值，增加高端产品的比重。目前公司核心技术的具体情况详见本募集说明书“第二节·四·（八）核心技术来源”。

**六、截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资**

**（一）财务性投资的认定标准**

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

金额较大是指公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

**（二）最近一期期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资**

截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产负债表中可能涉及财务性投资的主要科目包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款、其他流动资产、长期股权投资、其他非流动资产，具体分析如下：

**1、货币资金**

截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金情况如下：

单位：万元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 库存现金   | 8.90      |
| 银行存款   | 42,499.60 |
| 其他货币资金 | 38.85     |
| 合计     | 42,547.35 |

截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金主要为银行存款。其他货币资金主要为保证金及集团内境内外主体支付的未达款项等，不属于财务性投资。

## 2、交易性金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产情况如下：

单位：万元

| 项目                     | 期末账面价值    |
|------------------------|-----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,544.09 |
| 其中：理财产品                | 18,544.09 |
| 合计                     | 18,544.09 |

截至 2026 年 6 月 30 日，理财产品本金具体明细如下：

单位：万元

| 序号 | 理财产品                            | 本金金额     | 起始日期            | 终止日期                     | 年化预期利率/业绩比较基准 | 风险评级 |
|----|---------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|------|
| 1  | 招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款        | 6,000.00 | 2026 年 6 月 29 日 | 2026 年 7 月 29 日          | 1.00%~1.40%   | R1   |
| 2  | 中信证券资管信信向荣乐享 36 号 FOF (901DWS)  | 1,000.00 | 2025 年 3 月 17 日 | 持有 7 天后<br>可赎回           | 3.00%         | R2   |
| 3  | 中信证券资管信信向荣乐享 36 号 FOF (901DWS)  | 1,000.00 | 2025 年 4 月 7 日  | 持有 7 天后<br>可赎回           | 3.00%         | R2   |
| 4  | 中信证券资管信信向荣乐享 36 号 FOF (901DWS)  | 1,000.00 | 2025 年 4 月 30 日 | 持有 7 天后<br>可赎回           | 3.00%         | R2   |
| 5  | 中信证券资管信信向荣乐享 36 号 FOF (901DWS)  | 1,000.00 | 2025 年 6 月 18 日 | 持有 7 天后<br>可赎回           | 3.00%         | R2   |
| 6  | 中信证券资管信信向荣乐享 36 号 FOF (901DWS)  | 2,000.00 | 2026 年 3 月 5 日  | 持有 7 天后<br>可赎回           | 3.00%         | R2   |
| 7  | 中信证券信盈稳健(季中)6 号 FOF (代码 909A07) | 2,000.00 | 2026 年 3 月 9 日  | 持有 150 天后遇<br>开放期可<br>赎回 | 4.5%          | R3   |
| 8  | 浦银理财企安鑫 2653 期 (代码 PY300124)    | 2,000.00 | 2026 年 4 月 1 日  | 持有 124 天以上可<br>赎回        | 2.10%         | R2   |
| 9  | 兴银理财稳添利日盈 131 号 E (代码 XY205001) | 1,000.00 | 2026 年 6 月 3 日  | T+1 产品                   | 1.80%         | R1   |
| 10 | 民生理财贵竹周周盈 25 号                  | 1,300.00 | 2026 年 6 月 3 日  | 持有 7 天                   | 2.00%         | R2   |

|                          |           |        |       |  |  |
|--------------------------|-----------|--------|-------|--|--|
| F 最短持有期 7 天（代码 MS200002） |           | 月 25 日 | 以上可赎回 |  |  |
| 合计                       | 18,300.00 | -      |       |  |  |

注：序号 7 理财产品中信证券信盈稳健(季中)6 号 FOF 代码 909A07 为风险等级 R3 产品，截至 2026 年 6 月 30 日，公司购买该产品的本金为 2,000.00 万元。

公司于 2026 年 3 月 9 日以自有资金购入的风险等级为 R3 的理财产品“信盈稳健（季中）6 号”，合计金额 2,000.00 万元，R3 等级为中等风险，有亏损本金的可能性，收益浮动且有一定的波动，参考市场案例情况，公司将风险等级为 R3 的理财产品认定为财务性投资。2026 年 7 月 22 日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，发行人已从募集资金总额中调减上述 2,000.00 万元财务性投资金额。

除此之外，截至 2026 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产均为低风险或中低风险理财产品（R1 或 R2 风险等级），主要系公司为提高资金使用效率而购买，其安全性高、期限较短、流动性好、风险较低，不属于财务性投资。

### 3、其他应收款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

| 项目     | 期末账面余额 |
|--------|--------|
| 出口退税   | 349.95 |
| 代扣代缴费  | 200.75 |
| 保证金和押金 | 182.10 |
| 其他     | 20.08  |
| 合计     | 752.87 |

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款主要为出口退税、代扣代缴费、保证金和押金等，均不属于财务性投资。

### 4、其他流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

| 项目      | 期末账面价值   |
|---------|----------|
| 待抵扣进项税额 | 6,166.02 |
| 其他      | 1,244.22 |

| 项目 | 期末账面价值   |
|----|----------|
| 合计 | 7,410.24 |

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的其他流动资产主要为待抵扣进项税额，均不属于财务性投资。

### 5、长期股权投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司无长期股权投资。

### 6、其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

| 项目        | 期末账面价值   |
|-----------|----------|
| 预付设备款和工程款 | 1,805.04 |
| 合计        | 1,805.04 |

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的其他非流动资产为预付设备款和工程款，不属于财务性投资。

综上所述，截至 2026 年 6 月 30 日，公司持有风险等级为 R3 的 2,000.00 万元理财产品，已从募集资金总额中予以调减扣除，除此之外公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形。

### （三）自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司已投入或拟投入财务性投资的情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开董事会审议通过本次发行相关议案，自本次发行的董事会决议日前六个月至今，公司已实施的财务性投资系公司于 2026 年 3 月 9 日以自有资金购入的风险等级为 R3 的理财产品“信盈稳健（季中）6 号”，合计金额 2,000.00 万元，R3 等级为中等风险。除上述已投入的财务性投资外，公司无拟实施的财务性投资计划。上述财务性投资的具体情况如下所示：

#### 1、投资背景

报告期内，发行人营业收入分别为 131,469.14 万元、141,317.77 万元、193,173.02 万元和 123,262.33 万元，分别增长 7.49%、36.69%和 43.39%，营业收入的强劲增长为公司带来了持续的经营活动现金流入，由于项目投资进度安

排、利润积累等原因，会形成一定规模的暂时性闲置资金，发行人本次用于理财产品的资金为公司闲置自有资金，该资金来源于日常经营活动产生的现金流入与流出之间的时间差，属于暂时沉淀的流动性盈余，而非通过银行贷款、债券发行、股票发行等渠道筹措的资金。

## 2、投资目的

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对阶段性闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性较高的理财产品，是提升资金使用效率、增加资金收益的直接手段。有助于对冲部分财务成本并为股东创造更多回报。

选择 R3 风险等级的理财产品，且投资金额控制在 2,000.00 万元，反映了公司在风险与收益间的权衡。R3 级产品通常意味着本金亏损的可能性较低，但收益存在一定波动，区别于保本型的 R1 级产品，也远低于高风险等级的权益类投资。表明公司的投资策略相对审慎，旨在获取高于银行存款或货币基金的收益，同时将本金损失风险控制在可接受范围内。

公司进行此类投资的目的明确，主要出于财务管理的商业考量，符合上市公司通行做法。

## 3、投资期限及形成过程

公司于 2026 年 3 月 9 日以自有资金购入的风险等级为 R3 的理财产品“信盈稳健（季中）6 号”已于 2026 年 8 月 17 日赎回，投资期限低于 6 个月，属于短期投资。

## 4、财务性投资的认定依据

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

公司以自有资金购入的理财产品的风险等级为中等风险，有亏损本金的可能性，收益浮动且有一定的波动，基于属于财务性投资的金融产品具有收益波动大且风险较高的特点，并参考市场案例情况，公司将风险等级为中风险及以上的理财产品定义为财务性投资。

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求，2026 年 7 月 22 日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，发行人已从募集资金总额中调减上述 2,000.00 万元财务性投资金额。

七、同业竞争情况

（一）发行人是否存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业从事相同、相似业务的情况

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。公司控股股东为四会明诚，实际控制人为刘天明、温一峰和黄志成。

截至 2026 年 6 月 30 日，除本公司外，控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：

| 公司名称               | 主营业务 |
|--------------------|------|
| 四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙） | 实业投资 |
| 四会市一鸣投资有限公司        | 实业投资 |

上述公司与公司的主营业务均不相同，与公司不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争关系。

（二）避免同业竞争的承诺

1、控股股东避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，发行人控股股东四会明诚做出如下承诺：

（1）在本承诺函签署之日，四会明诚及其控制的其他企业均未直接或间接经营任何与四会富仕及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；

亦未投资任何与四会富仕及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。

(2) 自本承诺函签署之日起，四会明诚及其控制的其他企业将不直接或间接经营任何与四会富仕及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资任何与四会富仕及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。

(3) 自本承诺函签署之日起，若四会富仕及其下属子公司进一步拓展业务范围，四会明诚及其控制的其他企业将不与四会富仕及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与四会富仕及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则四会明诚及其控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入四会富仕经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(4) 本承诺函自签署之日起正式生效，在四会明诚作为四会富仕控股股东期间持续有效。如因四会明诚及其控制的其他企业违反上述承诺而导致四会富仕的利益及其它股东权益受到损害，四会明诚同意承担相应的损害赔偿责任。

截至本募集说明书出具之日，公司控股股东四会明诚同业竞争承诺履行情况良好，未发生同业竞争行为。

## 2、实际控制人避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，公司共同控制人刘天明、温一峰和黄志成做出如下承诺：

(1) 在本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业均未直接或间接经营任何与四会富仕及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未参与投资任何与四会富仕及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。

(2) 自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与四会富仕及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不参与投资任何与四会富仕及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。

(3) 自本承诺函签署之日起, 若四会富仕及其下属子公司进一步拓展业务范围, 本人及本人控制的其他企业将不与四会富仕及其下属子公司拓展后的业务相竞争; 若与四会富仕及其下属子公司拓展后的业务产生竞争, 则本人及本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入四会富仕经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(4) 本承诺函自签署之日起正式生效, 在本人作为四会富仕共同控制人期间持续有效。如因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致四会富仕的利益及其它股东权益受到损害, 本人同意承担相应的损害赔偿责任。

截至本募集说明书出具之日, 公司共同控制人刘天明、温一峰和黄志成同业竞争承诺履行情况良好, 未发生同业竞争行为。

## **八、未决诉讼、仲裁及行政处罚等相关情况**

### **(一) 发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚**

截至本募集说明书签署日, 发行人及其子公司不存在其他尚未了结的或可以合理预见的, 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上, 且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁, 亦不存在重大行政处罚。报告期内, 发行人涉及两项海关处罚及一项消防处罚, 具体情况如下:

#### **1、海关处罚**

2024 年 12 月 6 日, 公司收到中华人民共和国肇庆海关(以下简称“肇庆海关”)下发的肇关缉简违字〔2024〕41 号《行政处罚决定书》。因公司出口货物税则号申报不实, 影响海关统计, 涉及违反《中华人民共和国海关法》(以下简称“《海关法》”)第二十四条第一款规定, 肇庆海关根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第一项规定, 决定对公司罚款人民币 1,500 元。

2025 年 11 月 28 日, 公司收到肇庆海关下发的肇关缉简违字〔2025〕31 号《行政处罚决定书》。因公司进口货物保险费申报不实, 影响海关统计, 涉及违反《海关法》第二十四条第一款规定, 肇庆海关根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第一项规定, 决定对公司罚款人民币 1,500 元。

针对上述两项海关处罚, 公司已及时缴清罚款。结合海关监管有关规定对

进出口商品税则号列或进口货物保险费申报不实，影响海关统计准确性此种违法行为的处罚较轻，且上述两项海关处罚金额较小，故上述违法行为不构成对本次发行造成实质影响的重大违法行为。

## 2、消防处罚

2024 年 5 月，公司收到四会市消防大队下发的四消行罚决字[2024]第 0031 号《行政处罚决定书》。因发行人消防设施、器材配置、设置不符合标准、占用疏散通道、其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准，涉及违反《中华人民共和国消防法》（以下简称“《消防法》”）的相关规定。四会市消防大队根据《消防法》第六十条第一款第（一）项、第六十条第一款第（三）项及第六十一条第二款之规定分别给予公司罚款人民币 0.98 万元、2.49 万元、3.35 万元并责令公司综合楼停产停业整改。根据《消防行政处罚裁量权基准》规定，公司上述处罚均不属于严重违法情节。

针对上述处罚，公司已积极整改并及时缴清罚款。鉴于相关行为未造成严重社会影响，相关处罚不属于情节严重情形，且四会消防大队整改复查后认为公司已按规定整改，后续两次复查均合格，故上述行为不构成对本次发行造成实质影响的重大违法行为。

## （二）持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的重大诉讼、仲裁或行政处罚

截至本募集说明书签署日，持有发行人 5%以上股份的主要股东及发行人实际控制人不存在尚未了结的或可以合理预见的对本次发行构成实质性障碍的重大诉讼、仲裁事项或受到行政处罚的情形。公司控股股东四会明诚及一致行动人天诚同创存在一项行政监管措施，具体情况如下：

2026 年 5 月 19 日，上述两位股东收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对四会市明诚贸易有限公司、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）采取出具警示函措施的决定》（[2026]66 号）（以下简称“《警示函》”），《警示函》提出上述两位股东于 2025 年存在权益变动未及时披露并停止交易及超比例减持情况。针对前述违规行为，广东证监局决定对四会明诚和天诚同创采取出具警示函的行政监管措施，并要求四会明诚

及天诚同创收到此警示函之日起 15 日内向广东证监局提交书面整改报告。

四会明诚及天诚同创已按照广东证监局要求完成整改，并已向广东证监局提交了书面整改报告，本次监管措施不属于重大违法违规行为，不构成本次发行的实质性法律障碍。公司对该事项给予了高度重视，并已在日常经营过程中加强了对股东减持事项的管控，以杜绝同样情况后续再度发生。

### **（三）发行人董事、高级管理人员的重大诉讼、仲裁或行政处罚**

截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可以合理预见的对本次发行构成实质性障碍的重大诉讼、仲裁事项或受到行政处罚的情形。

## **九、报告期内交易所对发行人年度报告的问询情况**

公司于 2025 年 6 月 23 日收到深交所下发的《关于对四会富仕电子科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函[2025]第 587 号），公司于 2026 年 6 月 26 日收到深交所下发的《关于对四会富仕电子科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2026〕第 669 号），各年度问询函主要关注营业收入增长而净利润下滑、毛利率下降、应收账款期后回款情况、存货跌价准备计提是否充分等问题。

公司会同中介机构就相关问题进行了逐项落实，并分别完成了各年年报问询问题的回复。

## 第三节 本次证券发行概要

### 一、本次发行的背景和目的

#### （一）本次发行的背景

##### 1、国家产业政策持续出台，科技创新倒逼 PCB 产业发展

印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是：（1）为电路中各种元器件提供机械支撑；（2）使各种电子元器件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用；（3）用标记符号将所安装的各元器件标注出来，便于插装、检查及调试。PCB 可以实现电子元器件之间的相互连接，起中继传输的作用，是电子元器件的支撑体，是电子产品的关键电子互连件。

《“十四五”规划纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》、《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等政策文件明确提出要培育人工智能等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件等产业水平，并加快构建完善的国内电子信息产业链生态。这些政策为 PCB 产业提供了发展机遇，鼓励企业聚焦高端技术研发，突破国外技术垄断。

2025 年 10 月政府出台《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称“十五五规划”），“十五五规划”提出加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破；建设现代化产业体系，优化提升传统产业，培育壮大新兴产业和未来产业，巩固壮大实体经济根基；推动科技创新和产业创新深度融合。“十五五规划”明确了科技自立自强的重要性，对于 PCB 行业下游应用领域，“十五五规划”提出加快新能源、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，加快人工智能等数智技术创新，并推动脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业成为新的经济增长点。

PCB 作为“电子产品之母”，广泛应用于集成电路、新能源、航空航天、低空经济、人工智能、移动通信等战略性新兴产业和未来产业集群，提升 PCB 产业创新体系的整体效能，对于新质生产力产业落地具有关键支撑作用。

## 2、PCB 市场空间广阔，下游需求旺盛

PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业。2024 年，全球 PCB 产值为 735.65 亿美元。2025 年，受益于 AI 服务器、人工智能、高速通信、数据/存储、算力设施、智能驾驶及相关高速网络基础设施推动、智能手机市场复苏等，全球 PCB 产值达到 **858.36** 亿美元，同比增长 **16.7%**。自 2006 年开始，中国大陆超越日本成为全球第一大 PCB 生产地区，PCB 的产量和产值均居世界第一。2024 年，中国大陆 PCB 行业产值为 412.13 亿美元。2025 年，PCB 行业迎来结构性复苏，中国大陆 PCB 行业产值为 **496.52** 亿美元，较上年增长约 **20.48%**。中国大陆作为全球 PCB 行业的最大生产地区，占全球 PCB 总产值的比例已由 2000 年的 8.1% 上升至 **2025 年的 57.85%**。

未来在低碳化、智能化等因素的驱动下，5G 通信、云计算、智能手机、智能汽车、新能源汽车、人工智能等 PCB 下游应用行业预期将蓬勃发展，下游应用行业的蓬勃发展将带动 PCB 需求的持续增长。根据 Prismark 的最新预测，未来五年全球 PCB 市场将保持稳定增长，**2025 年至 2030 年全球 PCB 产值的预计年复合增长率达 11.0%**，至 **2030 年预计全球 PCB 市场将达到 1,446.10 亿美元**。

## 3、AI 产业快速崛起，推动高多层板和 HDI 板市场快速扩容

根据 IDC 发布的最新《全球人工智能支出指南》，2024 年中国政府在人工智能领域的支出规模为 25.5 亿美元，并以 25% 的增速持续领跑，成为 AI 应用的最大下游市场。技术的升级与政务数字化需求的扩容，为 PCB 相关业务提供了广阔的增长空间。

近年来，在 AI 驱动下，全球算力基础设施快速扩张，AI 服务器、高性能计算与网络通信设备开启新一轮周期，叠加汽车电动化与智能化进程加速带来的量价齐增，高多层板和 HDI 板等 PCB 产品需求快速增长，行业整体景气度保持上行趋势。为适应下游领域的需求，PCB 正向着高速、高频、集成化、小型化和轻薄化的方向发展，高多层板和 HDI 板等中高端 PCB 产品将保持强劲增长趋势。**2030 年高多层板和 HDI 板的市场规模将分别达到 585.63 亿美元、300.10 亿美元，2025-2030 年的复合增长率分别为 11.9%、13.1%。**

## （二）本次发行的目的

### 1、把握行业发展机遇，升级优化产品结构

近年来，AI 终端、低空经济、机器人、新能源、光模块等新质生产力发展迅速，为 PCB 行业带来广泛的市场空间。尤其是 AI 快速重塑市场新格局，算力密度持续上升，数据传输速率从低速率向 400G、800G、1.6T 等高速率持续跃升，PCB 不再仅是传统的支撑与互联的“电子产品之母”，而以更高层数、更精密的结构、和更先进的材料融入产品核心，成为产品不可分割的重要组成部分，并从单一连接结构件升级为系统级结构件，技术与价值实现了双重提升。PCB 行业在 AI 算力基础建设的推动下，让 PCB 迎来了质价升级的价值重估。公司持续加大研发创新力度，已掌握高多层高密度 HDI 互联技术、高多层背钻工艺技术、24~80 层 ATE 测试板技术、高频材料+FR4 混压技术、高频 77G 雷达 PCB 技术、HDI 铝基板的制作工艺研究与开发、厚铜（铜厚 4oz~15oz）PCB 技术、陶瓷 PCB 技术、50 层以上基板的制作工艺研究与开发、高多层刚挠结合板技术、Anylayer HDI 基板的制作工艺研究与开发、载板极薄铜箔的压合与加工、Mini LED 基板的制作工艺研究与开发、埋铜控深 PTH 基板的制作工艺研究与开发、嵌埋陶瓷复合基板的制作工艺研究与开发、Tenting 工艺 1.6T 光模块板制造技术、RCC 工艺 800G 光模块板制造技术、AI 加速卡高频混压 PCB 制造技术、高多层不对称结构背钻服务器基板制造技术等多项行业核心技术，使得公司在行业快速发展时代下，能把握发展机遇。

相比于传统 PCB，以服务器与光模块应用为特色的高多层和 HDI 板技术难度高、工艺复杂、附加值高。公司拟通过本次募集资金投资加快进入高多层、高技术、高附加值市场速度，扩大经营规模的同时快速推动产品技术升级，在下游新兴领域持续开拓，产能快速释放的同时，通过加大布局高多层板和 HDI 产品规模，公司可实现产品结构升级优化和业务范围的持续扩展，抢占更多市场份额，增强公司市场竞争力，进一步夯实未来发展根基。

### 2、提升公司产能，满足不断增长的市场需求

根据 Prismark 的预测，未来五年全球 PCB 市场将保持稳定增长，尤其是 AI 领域市场规模以两位数的复合增长率快速发展，成为推动行业发展的重要动

力。公司凭借成熟的产品体系、领先的行业地位和丰富的行业经验，正迎来更广阔的市场空间，但公司现有中高端产能已难以支撑业务发展目标。

公司正处于产品结构升级和转型的关键时期，本次募投项目将新增高多层板和 HDI 板产能，通过购置大批量自动化生产的先进设备，巩固原有优势产品的同时，在服务器、光模块等高价值产品进行产线布局，突破公司在工业控制和汽车电子领域形成的以中小批量与高度柔性产线为特色的产能瓶颈，增强公司在服务器、光模块等领域的竞争力，实现公司业务转型升级和快速发展。同时本次产能的扩张有利于公司迅速抓住市场发展需求，进一步扩大公司市场份额，提升行业影响力。

本次募投项目主要投向下游景气度高、技术密集的市场增长领域，提升现有产能规模和供给弹性，以便更好承接下游市场快速发展和结构性增长的机遇，在现有服务器和光模块快速发展的基础上，打开更广阔的市场空间，为国内外客户提供更稳健的支撑，并为承接新兴优质客户奠定产能基础。

### 3、优化公司现有产品与客户结构，培育第二、第三增长曲线

公司长期深耕工业控制与汽车电子等领域，与日立、松下、欧姆龙、横河电机、安川电机等全球工控头部企业建立了稳固的合作关系，汽车电子领域也从车钥匙、车灯、天线与车载娱乐系统等简单部件向 ECU、T-BOX、P-Box、转向马达、激光雷达、发动机控制板等核心安全部件渗透。依赖少数几个下游领域可能使公司增长受限，公司紧贴行业发展趋势与客户需求，巩固原有优势领域的同时，积极拓展以服务器与光模块为代表的新兴领域，提升高多层板和 HDI 板产能，是公司主动进行产品与客户结构优化、培育新增长点的战略需要。

从产品结构看，工控和传统汽车电子 PCB 对可靠性要求较高，但产品层数和技术复杂度低于服务器、光模块所用的高多层板和 HDI 板，其附加值、毛利率通常相对较低。公司工控和汽车电子领域客户分散，单一客户销售占比较低，不利于公司快速做大做强。通过募投项目增加高端产品的产能和销售规模，能够有效提升公司的整体盈利水平和抗风险能力，从而增强公司市场竞争力。

从客户结构看，进军服务器和光模块领域市场，公司将会与全球知名的云计算厂商、服务器品牌商、网络设备商以及芯片设计公司建立合作关系。这类

客户不仅订单规模大，且通常与供应商深度绑定，合作周期长，有利于公司建立长期稳定的合作关系和大客户战略的实施。公司募投项目的扩产是向“服务器+光模块”等新兴领域进行多元化扩张的关键一步，打造多领域布局、梯队式发展的增长格局。

#### 4、充实公司资金实力，助力公司快速发展

公司所处行业为技术密集型和资金密集型行业，技术研发、生产运营均需大量资金投入，目前，公司正处于产品结构升级及转型的重要机遇期，随着 PCB 市场空间持续扩大，高端产品快速涌现，行业呈现典型的技术驱动特征。客观上促使行业参与者在技术创新与成果转化等方面加大投入，在巩固既有业务的同时，还需持续聚焦新技术突破、新产品落地及新市场拓展。为了抢占服务器、光模块等新兴领域市场，同时筑牢技术优势、抢抓发展机遇，亟需投入大量资金，公司资金面日益承压。

当前，全球 PCB 行业正处于市场需求与技术复杂度双重跃升的关键分水岭，为了满足未来业务发展需要，公司将不断加快服务器、光模块等新兴领域的拓展，进一步加大在技术研发、人才储备、生产设备、市场开发等方面的投入，增强公司市场竞争力。本次发行有利于公司补充发展资金，充实资金实力，推动公司发展战略进一步落地。

## 二、发行对象与发行人的关系

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次最终发行对象由股东会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。若国家法律、法规对此有新的规

定，公司将按新的规定进行调整。

截至本募集说明书出具日，公司尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

### 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

#### （一）本次发行证券的价格或定价方式

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股或资本公积转增股本等事项，公司将按照深交所的相关规则对前述发行底价作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中： $P_0$  为调整前发行底价， $P_1$  为调整后发行底价， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送股或转增股本数。

本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，按照相关规定根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

#### （二）发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，按本募集说明书出具之日的总股

本计算即不得超过 48,156,349 股（含本数），最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册批复后，由公司董事会根据股东会授权，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行对象申购报价情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将根据深交所和中国证监会相关规定进行相应调整。

### （三）限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

## 四、募集资金数额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 93,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

| 单位：万元 |                                                     |      |            |           |
|-------|-----------------------------------------------------|------|------------|-----------|
| 序号    | 项目名称                                                | 实施主体 | 项目投资总额     | 拟以募集资金投入  |
| 1     | 年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期） | 四会富仕 | 109,236.13 | 93,000.00 |
| 合计    |                                                     |      | 109,236.13 | 93,000.00 |

注：经第三届董事会第二十二次会议审议通过，已调减本次发行董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元。

在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额投入募投项目，募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次向特

定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## 五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书出具日，公司尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

## 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人控股股东为四会明诚，持有公司 33.18% 股份，为公司控股股东。刘天明、温一峰和黄志成以及四会明诚、天诚同创、一鸣投资共同签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系，刘天明、温一峰和黄志成通过四会明诚、天诚同创、一鸣投资合计控制发行人 50.59% 的股份；刘天明直接持有公司 2.31% 的股份；温一峰直接持有公司 2.31% 的股份；刘天明、温一峰和黄志成共同控制公司 55.21% 的股份，为公司实际控制人。

本次发行不超过 48,156,349 股（含本数），按此上限测算，本次发行完成后四会明诚合计控制公司 25.52% 的股份，实际控制人刘天明、温一峰和黄志成共同控制公司 42.47%，四会明诚仍为公司的控股股东，刘天明、温一峰和黄志成仍为公司共同实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

## 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行股票的发行方案于 2026 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，于 2026 年 4 月 30 日经公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过。财务性投资调减募集资金涉及相关发行方案修订事项已于 2026 年 7 月 22 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

本次向特定对象发行股票已经深圳证券交易所审核通过，尚需中国证监会予以同意注册。

## 八、本次证券发行满足“两符合”和不涉及“四重大”相关规定

### （一）满足“两符合”的相关规定

#### 1、本次发行符合国家产业政策

公司主营业务为印制电路板（PCB）产品的研发、生产和销售，是电子信息产业中活跃且不可或缺的重要组成部分。公司 PCB 产品类型丰富，覆盖高多层板、HDI 板、厚铜板、金属基板、陶瓷基板、软硬结合板、高频高速板、埋嵌铜块基板等品类，满足下游领域对 PCB 的各种需求。产品广泛应用于工业控制、汽车电子、通信设备、医疗器械、新能源、消费电子等领域。根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3982 电子电路制造”。

##### （1）募集资金投资项目不属于淘汰类、限制类产业

公司本次募投项目为年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期），根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2024 年本），“新型电子元器件制造：高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板、高密度高细线路（线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$ ）柔性电路板等”被列为“鼓励类”发展产业。本次募投项目不属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中产能过剩行业或限制类、淘汰类行业，未被纳入《市场准入负面清单（2025 年版）》禁止准入类或许可准入类事项名单，符合国家产业政策要求。

##### （2）募集资金投资项目不属于落后产能

本次募投项目不涉及《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7 号）、《关于印发〈淘汰落后产能工作考核实施方案〉的通知》（工信部联产业〔2011〕46 号）、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41 号）、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30 号）、《2015 年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告 2016 年第 50 号）以及《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2020〕

901 号) 中的落后产能。

公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后, 募集资金净额将投资于高多层板及 HDI 电路板业务, 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

## **2、本次发行符合板块定位（募集资金主要投向主业）**

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 **93,000.00** 万元, 扣除发行费用后, 募集资金拟用于“年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）”项目。公司本次募集资金投向围绕公司 PCB 主业进行布局, 旨在增加公司高多层板及 HDI 产能。项目建成达产后, 将形成年产 60 万平方米高多层及 HDI 电路板产能。

本次募投项目围绕公司 PCB 主营业务展开, 募集资金不存在投向非主营业务的情形。

## **（二）不涉及“四重大”的情形**

截至募集说明书签署日, 公司主营业务及本次发行募投项目不涉及情况特殊、复杂敏感、审慎论证的事项; 公司本次发行不存在重大无先例事项; 不存在影响本次发行的重大舆情; 不存在相关投诉举报、信访等重大违法违规线索, 本次证券发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

综上所述, 公司本次发行满足“两符合”的相关规定, 不涉及“四重大”的相关情形, 符合《注册管理办法》第三十条、《证券期货法律适用意见第 18 号》以及《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

## **九、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据及融资间隔相关情况**

### **1、关于本次证券发行数量**

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》, 上市公司申请向特定对象发行股票的, 拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十。

截至 **2026 年 6 月 30 日**, 上市公司的总股本为 160,521,165 股, 本次股票发行数量不超过 48,156,349 股 (含本数), 未超过发行前公司总股本的 30%, 符合

发行数量的要求。

## 2、关于融资间隔

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。

公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2020 年 7 月 3 日，公司前次募集资金为 2023 年的向不特定对象发行可转换公司债券，前次募集资金到账时间为 2023 年 8 月 14 日。公司本次向特定对象发行股票的董事会决议日为 2026 年 4 月 8 日，董事会决议日前十八个月不存在首发、增发、配股、向特定对象发行股票，因此，公司本次融资符合融资时间间隔的要求。

## 3、关于募集资金用于补充流动资金和偿还债务等非资本性支出

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应当充分论证其合理性，且超过部分原则上应当用于主营业务相关的研发投入。

本次向特定对象发行股票拟募集资金为 **93,000.00** 万元，未用于补充流动资金和偿还债务。发行人本次发行募集资金用于“年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）”，其中涉及的以募集资金投入的非资本性支出为铺底流动资金，合计 **3,457.61** 万元，占募集资金总额的比例为 **3.72%**，不超过募集资金总额的 30%，符合相关要求。

综上，本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定。

## 十、因实施募投项目而新增的折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响

公司本次募投项目的实施将会使公司固定资产规模增大，并将在达到预定

可使用状态后计提折旧，未来将增加公司折旧费用，在一定程度上影响公司的利润水平。本次募投项目建成后，预计达产年新增固定资产折旧及无形资产摊销 7,211.20 万元。在项目顺利实施后预计效益能够较好地消化新增折旧摊销的影响，经测算募投项目经济效益良好。但由于影响募集资金投资项目效益实现的因素较多，若因募投项目实施后，市场环境等发生重大不利变化或公司市场拓展不及预期，导致募投项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平，则新增固定资产及无形资产折旧摊销将对发行人未来的盈利情况产生不利的影响。

## 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 **93,000.00** 万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                                | 实施主体 | 项目投资总额            | 拟以募集资金投入         |
|----|-----------------------------------------------------|------|-------------------|------------------|
| 1  | 年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期） | 四会富仕 | 109,236.13        | <b>93,000.00</b> |
| 合计 |                                                     |      | <b>109,236.13</b> | <b>93,000.00</b> |

注：经第三届董事会第二十二次会议审议通过，调减本次发行董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 **2,000.00** 万元。

上述项目的实施主体为四会富仕。本次募集资金到位后，公司根据制定的募集资金投资计划具体实施。在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

### 二、本次募集资金投资项目的具体情况

#### （一）项目基本情况

| 类别     | 内容                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称   | 年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期） |
| 实施主体   | 四会富仕电子科技有限公司                                        |
| 总投资    | 109,236.13 万元                                       |
| 主要建设内容 | 建设应用于服务器、光模块及工控、汽车电子等领域的高多层、HDI 电路板                 |
| 建设地点   | 四会市龙甫镇惠源三路 1 号                                      |

## （二）本次募集资金投资项目的必要性

### 1、顺应高端 PCB 市场结构性高速增长的核心趋势，抢占未来增长主赛道

当前全球 PCB 产业正经历深刻的结构性变革，传统低端产品增长趋缓，而高端产品，特别是高多层板和 HDI，正成为驱动行业增长的核心引擎。对于公司而言，持续拓展高多层板和 HDI 板等高端产品是对公司未来增长曲线的战略性重塑，是其在新一轮产业升级中立足的关键举措。

从市场规模与增速看，高端 PCB 市场发展迅速。根据 Prismark 的数据，**2025 年**，高多层板和 HDI 板的产值分别实现了 **19.30%**和 **29.58%**的同比增长，是所有 PCB 细分产品中增长最快的领域，预计 **2025-2030 年**高多层板和 HDI 板复合增长率分别为 **11.9%**和 **13.1%**。

从下游应用驱动力分析，增长动能强劲。AI 算力基础设施、高速网络通信、智能电动汽车等新质生产力领域正成为高端 PCB 需求快速增长的关键。以 AI 服务器为例，其 GPU 板组扩容、架构升级对 PCB 的层数、材料及工艺提出了更高要求，推动 PCB 向高密度化、高集成化方向演进。

### 2、突破技术壁垒，构建面向未来的核心竞争力与护城河

高多层板和 HDI 板，尤其是应用于服务器、光模块等领域的高端产品，其制造工艺复杂，是涉及材料学、精密加工、信号完整性设计等多学科交叉的复杂系统工程。继续拓展高多层板和 HDI 板等高端产品，推动公司技术能力完成质的飞跃，从而构建起公司的核心竞争力和护城河。

高多层板的技术挑战核心在于“高密度”与“高性能”的协同实现。随着层数向更高迈进，对 PCB 的层间对准度、阻抗一致性、散热性能及长期可靠性要求提高。HDI 板的技术壁垒则集中体现在“互连”和“高复杂度”上。HDI 通过使用微盲孔、埋孔来替代传统通孔，极大提升了单位面积的布线密度。高阶 HDI 的制造工艺需要循环重复“层压-激光钻孔-微孔电镀-线路”的工序，每增加一阶，良率控制的难度和成本都呈指数级上升，要持续开拓高端 HDI 市场，仍需在设备、工艺和人才上进行大规模、持续性的投入。本次募集资金是跨越这些关键的技术的资金保障，使公司从“具备能力”升级为“具备稳定、批量生产高端产品的能力”，从而在价值链上占据更有利的位置。

### 3、把握 AI 算力爆发与硬件迭代的历史性机遇，切入高附加值客户供应链

当前，以生成式人工智能为代表的科技革命正驱动全球算力基础设施快速扩张，不仅带来了量的增长，更引发了硬件架构的快速迭代，从而为上游 PCB 供应商创造了结构性的、高附加值的增量市场。公司持续拓展高多层板和 HDI 板业务，是为了完成从当前以工控、汽车电子为主的客户结构，向代表科技前沿的 AI 算力客户群延伸。

AI 服务器是高端 PCB 需求爆发的核心载体。一台 AI 服务器中，其 PCB 需求主要来自三个部分：（1）用于高密度互连的小型 AI 加速器模块（如 OAM），通常使用 4-5 阶 HDI；（2）通用基板（UBB），通常使用高多层板或 HDI；（3）CPU 主板，通常使用 14-20 层 PCB 板。根据 Prismark 数据，2023 年 AI/HPC 服务器的全球 PCB 市场规模接近 8 亿美元，预计到 2028 年将增长至 31.7 亿美元，2023-2028 年复合年增长率高达 32.5%，为 PCB 厂商提供了持续的订单和溢价空间。

公司要成为 AI 领域的核心供应商，需拥有规模化的高端产能和经过认证的稳定制程能力。公司当前的产能以满足样品和小批量需求为主，募投项目提升了公司生产大批量高多层板和 HDI 板的能力，是公司成为 AI 领域核心供应商的关键。

### 4、响应国家战略与产业政策导向，服务制造业高端化与自主可控大局

公司募投项目高度契合国家推动制造业高端化、智能化、绿色化发展的战略方向，符合增强产业链、供应链自主可控能力的政策诉求。

高多层板和 HDI 板是电子信息产业的基础核心部件，其技术水平直接关系到下游 5G 通信、人工智能、数据中心、新能源汽车、网络通信等战略性新兴产业的发展质量和安全。当前，全球高端 PCB 产能主要集中在中国台湾、日本、韩国等地区的少数厂商手中。中国大陆 PCB 产业虽规模全球第一，但在产品结构上仍以中低端为主，推动本土 PCB 企业向高多层、高阶 HDI 等高端领域突破，是中国实现电子信息产业自立自强的重要一环。

公司募投项目所生产的高多层板及 HDI 板产能，巩固现有优势产品的同时，将直接应用于服务器、智能终端、光模块等国家明确鼓励发展的重点领域，通

过本土化供应，降低下游重点产业对海外供应链的依赖，有利于提升整个产业链的韧性和安全水平。从资本市场和长期发展的角度看，符合国家战略导向的产业投资，更容易获得包括政策支持、银行信贷、市场认可在内的多方面资源倾斜，为公司穿越周期、持续成长营造更有利的外部环境。

### **5、应对高昂的资本开支需求，为先进产能建设与设备升级提供资金保障**

高端 PCB 制造属于典型的技术密集型和资本密集型行业。从普通多层板向高多层、高阶 HDI 升级，需要新建或大规模改造厂房，并投入大量资金购置一系列专用生产设备，本次募集资金是应对这一资本开支的重要保障。

设备投资是高端 PCB 产能建设的最大支出项。以高多层板和 HDI 板为例，层数的增加、阶数的提升和材料的变化导致钻孔效率大幅降低，加工同样面积产品所需设备数量增加，且对高精度钻孔机需求提升。若仅依靠自身经营积累进行如此大规模的投资，将拖累公司现金流，错失市场快速发展的时间窗口。因此，通过资本市场进行股权融资，是平衡公司短期财务压力与长期战略投入、以最快速度搭建先进产能平台的最优选择。

### **（三）本次募集资金投资项目的可行性**

#### **1、深厚技术积累，为高端产能提供工艺支撑**

自成立以来，公司始终专注于高品质 PCB 的研发与生产，在技术领域形成了深厚的积累，这为其向更高层次的高多层板和 HDI 板业务拓展提供了坚实的技术支撑。

从研发体系与成果来看，公司已建立起成熟的创新机制，并获得了权威认可。公司是国家高新技术企业，获得了肇庆市企业技术中心、肇庆市工程技术研究中心、广东省高可靠性电路板设计与制造工程技术研究中心、广东省企业技术中心等认定，在高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。同时，公司形成了高多层高密度 HDI 互联技术、高多层背钻工艺技术、24~80 层 ATE 测试板技术、高频材料+FR4 混压技术、高频 77G 雷达 PCB 技术、HDI 铝基板的制作工艺研究与开发、厚铜（铜厚 4oz~15oz）PCB 技术、陶瓷 PCB 技术、50 层以上基板的制作工艺研究与开发、高多层刚挠结合板技术、Anylayer HDI 基板的制作工艺研究与开发、载板极薄铜箔的压合与加工、Mini LED 基板的制

作工艺研究与开发、埋铜控深 PTH 基板的制作工艺研究与开发、嵌埋陶瓷复合基板的制作工艺研究与开发、Tenting 工艺 1.6T 光模块板制造技术、RCC 工艺 800G 光模块板制造技术、AI 加速卡高频混压 PCB 制造技术、高多层不对称结构背钻服务器基板制造技术等多项行业核心技术。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已经取得发明专利 19 项，能够为高端产品的持续开发提供体系化的技术保障。

公司在泰国设立的生产基地已于 2024 年下半年开始逐渐投产，在技术上，公司攻克了高多层板和 HDI 板的核心制造工艺，掌握了从材料选型、图形转换、精密激光钻孔、层压对位、电镀填孔等一系列关键技术环节，能够满足光模块、服务器等对高可靠性、低阻抗的品质要求，已实现了高多层板与 HDI 板等产品的量产，为公司在国内建设更先进、更大规模的高端产能提供了宝贵的工艺参数、生产管理经验、人才储备和量产经验。

## 2、头部客户资源构成强大市场准入壁垒与客户转化基础

公司长期专注于工业控制、汽车电子等高可靠性 PCB 市场，与全球顶级客户建立的长期信任关系，构成了公司进军高多层板和 HDI 板市场坚实的护城河和可行性保障。

首先，工业控制和汽车电子对 PCB 的长期可靠性、耐高温、耐振动、耐腐蚀以及低缺陷率要求严苛，公司在工控领域与头部企业松下、欧姆龙、安川电机、横河电机等知名客户建立了长期稳定的合作关系，在汽车电子领域从车钥匙、车灯、天线与车载娱乐系统等简单部件向 ECU、T-BOX、P-Box、转向马达、激光雷达、发动机控制板等核心安全部件渗透，公司的质量管理体系、生产过程控制能力、品控能力已达到国际一流水平。服务器、光模块领域对 PCB 的可靠性和信号完整性要求极高，公司具备深厚高可靠性制造背景，产品品质更容易获得新开发领域客户的认可，客户信任建立更快。

其次，现有头部客户资源存在巨大纵向挖掘与横向拓展潜力。公司的客户结构优质，且正在持续多元化。一方面，其传统的日系头部客户本身也在进行产业升级，其高端工控设备、机器人等产品对高多层板和 HDI 板的需求增长，公司可凭借长期合作建立的信任，优先获得老客户升级产品的订单，实现业务的自然延伸；另一方面，公司已成功开拓了服务器、光模块等领域的客户群，

并获得了订单的高速增长。从工控、汽车电子的全球巨头，到服务器、光模块等领域的拓展，公司已构建了一个层次丰富、需求多元的优质客户池，这为新产能的消化提供了多层次的保障。

### 3、强大的人才队伍为项目实施提供保障

公司在多年的经营发展中，形成了较稳定、专业且具有丰富行业经验的管理团队。公司董事长刘天明先生毕业于日本东京大学，有着十多年的日资 PCB 企业工作和管理经验，公司核心员工多年在 PCB 企业从事生产、技术、销售、管理，对电路板生产制造及品质管理理念有着深刻理解，熟悉客户的工作流程和管理风格，能够与客户进行积极有效沟通。公司人员结构稳定，本地员工占 70%以上，为本地员工提供有竞争力的薪酬；公司还通过股权激励机制吸引人才，增加员工对公司的归属感，为持续稳定生产高品质的 PCB 提供保证。

### 4、下游 AI 算力与汽车电子需求爆发，为新增产能提供了订单空间

高多层板和 HDI 板的下游需求正经历由 AI 算力和汽车智能化驱动的结构性能爆发，为公司的新增产能提供了订单保障。

首先，AI 服务器对高端 PCB 的需求呈指数级增长，且其技术迭代快、产品附加值高，生成式 AI 的浪潮推动全球算力基础设施疯狂扩张。AI 服务器刺激 PCB 的需求爆发式增长，据广东省电路板行业协会数据，每一台 AI 服务器的 PCB 产值较传统服务器提升 5~7 倍，根据 Prismark 预测，2023-2028 年 AI 服务器相关 HDI 板的年均复合增速为 16.3%。公司光模块板产品技术能力得到市场前沿客户的认可，已获得客户批量订单，AI 服务器领域订单增长迅速，为新增产能消化提供保障。

其次，汽车智能化与电动化推动车用 PCB 市场量价齐升，高阶 HDI 渗透率快速提高。汽车电子领域是公司传统优势领域，这一领域正在发生深刻变革，新能源汽车的电子元件是传统燃油车的 3-4 倍，三电系统（电池、电机、电控）需要大量高可靠性 PCB，智能驾驶和智能座舱对数据处理能力要求飙升，推动车用 PCB 向高层数、高密度发展。公司已从车钥匙、车灯、天线与车载娱乐系统等简单部件向 ECU、T-BOX、P-Box、转向马达、激光雷达、发动机控制板等核心安全部件，具备了供应车规级高阶产品的基础。随着客户车型的迭代升

级，对高阶 HDI 和高多层板的需求将会向公司释放，保障新增产能相当一部分可以被汽车电子业务消化。

#### （四）项目投资概算

本项目总投资金额为 109,236.13 万元，本次拟使用募集资金投入 93,000.00 万元，项目投资结构如下：

单位：万元

| 序号 | 项目        | 投资金额       | 占比      |
|----|-----------|------------|---------|
| 1  | 建筑及安装工程费用 | 8,462.34   | 7.75%   |
| 2  | 设备购置及安装费用 | 76,067.35  | 69.64%  |
| 3  | 环保设备设施    | 3,369.46   | 3.08%   |
| 4  | 工程建设其它费用  | 10,455.26  | 9.57%   |
| 5  | 铺底流动资金    | 10,881.72  | 9.96%   |
| 合计 |           | 109,236.13 | 100.00% |

注：经第三届董事会第二十二次会议审议通过，调减本次发行董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元。

公司本次募投项目募集资金金额未超过项目投资总额。公司年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）拟使用募集资金 93,000.00 万元，项目总投资额为 109,236.13 万元，其中固定资产投资 98,354.41 万元，占总投入金额的 90.04%，铺底流动资金 10,881.72 万元，占总投资比例 9.96%。此外，董事会前已投入固定资产投资金额 8,812.02 万元不能纳入募集资金投入，则公司本次拟以募集资金投入的资本性支出为 89,542.39 万元，拟以募集资金投入的铺底流动资金为 3,457.61 万元，本次募投项目中以募集资金投入的非资本性支出占本次拟使用募集资金总额的 3.72%，未超过 30%，符合《上市公司证券发行注册管理办法—证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

#### （五）项目经济效益

经测算，本项目税后静态投资回收期为 7.49 年（含建设期），税后内部收益率为 13.65%。

#### （六）效益预测的假设条件及主要计算过程

本项目实施完毕后，主要经济效益指标如下：

| 序号 | 经济技术指标 | 数据 | 备注 |
|----|--------|----|----|
|----|--------|----|----|

|   |           |            |         |
|---|-----------|------------|---------|
| 1 | 年销售收入（万元） | 109,206.00 | 达产年度    |
| 2 | 年利润总额（万元） | 11,937.04  | 达产年度    |
| 3 | 内部收益率（%）  | 13.65      | 税后      |
| 4 | 投资回收期（年）  | 7.49       | 税后，含建设期 |

### 1、效益预测的假设条件

- （1）国家现行法律、法规无重大变化，行业的政策及监管法规无重大变化；
- （2）募投项目主要经营所在地及业务涉及地区的社会、经济环境无重大变化；
- （3）行业未来形势及市场情况无重大变化；
- （4）人力成本价格不存在重大变化；
- （5）行业涉及的税收优惠政策将无重大变化；
- （6）募投项目未来能够按预期及时达产；
- （7）募投项目销售量即按照生产量测算；
- （8）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### 2、营业收入测算

本项目营业收入的测算以 2025 年公司分层产品市场价格为基础并结合目标客户产品现有价格情况保守估计未来市场价格，同时根据项目的投资进度和运行情况估算投产后各年分层产品销量，分层产品预估价格分别乘以销量合计为本项目营业收入。

### 3、成本测算

本项目生产成本主要为直接材料费、直接人工成本和制造费用，直接材料费用参照同类产品成本数据估算确定，直接人工成本由定员人数及预计平均工资确定。制造费用由生产管理人员成本、折旧摊销、燃料及动力费构成。

### 4、期间费用测算

本项目期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用。根据公司 2025 年度销售费用、管理费用、研发费用占营业收入的比例来进行测算。

5、税金测算

项目税金及附加的测算主要包含增值税、所得税、城市维护建设税、教育费附加等，相关税负按照税收法律法规的有关规定测算。

(七) 项目实施地点

本项目建设地点位于四会市龙甫镇惠源三路 1 号，项目用地已由四会富仕以出让方式取得。公司已取得项目实施地编号为粤（2026）四会市不动产权第 0008304 号、粤（2026）四会市不动产权第 0008316 号、粤（2026）四会市不动产权第 0008321 号和粤（2026）四会市不动产权第 0008336 号的不动产权证书。

截至本募集说明书出具日，肇庆市生态环境局出具了《关于四会富仕技术有限公司年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目环境影响报告表的审批意见》，肇庆市生态环境局四会分局于 2026 年 4 月 8 日出具《关于对<关于四会富仕技术有限公司主体变更的申请>的意见》，环评建设项目主体变更为四会富仕。发行人已完成项目备案的相关工作，取得了《广东省企业投资项目备案证》。

(八) 项目实施安排

本项目采用边建设边投产的方式，项目建设期 1.5 年，建成后的第 3 年达产 100.00%，本项目建设进度具体情况如下：

| 阶段/时间（月） | T+18 |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|
|          | 2    | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 可行性研究    |      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 初步规划、设计  |      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 房屋建筑及装修  |      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 设备采购及安装  |      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 人员招聘及培训  |      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 试运行及投产   |      |   |   |   |    |    |    |    |    |

在项目实施过程中，公司将根据行业发展及市场需求情况及时调整项目的具体实施进度和募集资金使用进度。

### 三、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

#### （一）实施能力

针对本次募投项目，公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备，公司具备募投项目的综合执行能力。相关情况如下：

##### 1、人员储备

自公司成立以来，一直将人才团队的建设与培养视为公司主要的发展目标之一。在人员储备方面，公司拥有一批专业知识扎实、自主研发创新能力强、实战经验丰富的专业研发人才团队，核心技术人员均为印制电路板行业的资深专家，具有长期、丰富的生产及技术研究开发经验。同时公司已经形成了一套成熟的管理制度与研发制度，组建了一支多层次、专业性强、经验丰富的管理团队和研发团队。且公司地处珠三角一隅，员工主要以本地为主，稳定度强，流失率低，人才储备充足，有助于公司实现高效稳定的管理，顺利应对市场环境变化，保持持续、稳定的创新能力，为本次募集资金项目的顺利实施提供了重要保障。

此外，公司各部门将按照本次募集资金投资项目的实施计划，对所需的专业人员进行提前规划，使得募集资金投资项目拥有充足且专门的人力储备。同时，针对募集资金投资项目所需要的新技术，公司也将加强相关人员的培训工作，确保相关人员能够胜任相关工作。

##### 2、技术储备

公司是国家高新技术企业，获得了肇庆市企业技术中心、肇庆市工程技术研究中心、广东省高可靠性电路板设计与制造工程技术研究中心、广东省企业技术中心等荣誉称号。

公司作为国内领先的印制电路板制造商，长期以来，一直坚持技术驱动市场发展战略，紧密关注行业的核心技术发展动态，及时获取前沿技术信息，以在技术和产品的研发上具有较强的前瞻性。且公司的主要客户均为世界知名行业领先企业，通过不断参与客户产品研发合作、收集和分析下游产品的变化信息，也可及时掌握客户需求的变化及当下最前沿的产品标准及技术情况并进行对应的技术前期开发。

经过公司研发团队长期自主研发，公司已相继开发高多层高密度 HDI 互联技术、高多层背钻工艺技术、24~80 层 ATE 测试板技术、高频材料+FR4 混压技术、高频 77G 雷达 PCB 技术、HDI 铝基板的制作工艺研究与开发、厚铜（铜厚 4oz~15oz）PCB 技术、陶瓷 PCB 技术、50 层以上基板的制作工艺研究与开发、高多层刚挠结合板技术、Anylayer HDI 基板的制作工艺研究与开发、载板极薄铜箔的压合与加工、Mini LED 基板的制作工艺研究与开发、埋铜控深 PTH 基板的制作工艺研究与开发、嵌埋陶瓷复合基板的制作工艺研究与开发、Tenting 工艺 1.6T 光模块板制造技术、RCC 工艺 800G 光模块板制造技术、AI 加速卡高频混压 PCB 制造技术、高多层不对称结构背钻服务器基板制造技术等多项行业核心技术。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已经取得发明专利 19 项，通过这些技术的运用，公司可向工业控制、汽车电子、交通、通信设备、医疗器械、新能源、光模块、AI 服务器等高可靠性要求的产品领域提供相应产品，满足不同客户的需求。未来公司还将进一步加大研发相关的投入，提高相关新技术的产出能力、相关技术人才的管理能力，为本次募投项目的顺利实施提供强有力的技术保障。

### 3、市场储备

公司深耕行业多年，始终以客户为中心，凭借优质的产品质量、长期稳定的高效生产能力以及快速响应客户的服务，与下游相关行业的多家公司建立了长期稳定的合作关系。公司主要客户为国内外上市公司和知名 EMS 厂商，电子产品制造商知名客户包括世界 500 强松下（Panasonic）、日立（HITACHI）、住友集团（Sumitomo Group），欧姆龙（OMRON）、岛津（SHIMADZU）、基恩士（KEYENCE）、横河电机（YOKOGAWA），及山洋电气（SANYODENKI）、古野电气（FURUNO）、希克斯（SIIX）等知名日本上市公司，罗克韦尔（Rockwell Automation）、禾赛科技等美国上市公司，万特集团（VENTURE）等新加坡上市公司，禾川科技、美的集团等国内上市公司，全球排列靠前 EMS 客户加达利（KATOLEC）、三和盛（UMC）、GPV 集团等。全球排名前列的 PCB 生产企业包括客户 B、S&H INCOTEC Electronic GmbH、中央铭板（CMK）、兴电集团（KYODEN）、京写（KYOSHA）等上市公司。全球知名贸易商客户包括艾佳普（ICAPE）、丰田通商株式会社等知名上市公司。

同时，公司注重与客户建立长期战略合作关系，与重点客户已合作多年，业务关系稳定，多次获得客户颁发的产品质量奖项，包括欧姆龙（OMRON）的集团质量体系认证、岛津（SHIMADZU）、山洋电气（SANYODENKI）、安川电机（YASKAWA）的优秀供应商奖。同时公司已成功开拓了服务器、光模块等领域，并获得了订单的高速增长。从工控、汽车电子的全球巨头，到服务器、光模块领域的拓展，公司已构建了一个层次丰富、需求多元的优质客户池，丰富且优质的客户资源及稳定的客户合作关系将为本次募投项目的建设及投产奠定良好的市场基础。

综上，公司在人员、技术和市场等方面具备丰富的储备，能够为本次发行募集资金投资项目的实施提供有力保障。

## **（二）资金缺口的解决方式**

本次募投项目总投资额为 109,236.13 万元，拟使用募集资金投资金额为 93,000.00 万元。本次募集资金到位后，公司根据制定的募集资金投资计划具体实施。在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。

## **四、本次募投项目相关既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性**

### **（一）本次募投项目与公司既有业务的关系**

公司专注于 PCB 主业，持续推进高端产能扩建，并通过技术创新和智能化升级，保持核心业务的稳步增长。公司本次向特定对象发行募集资金投资的项目系围绕公司主营业务开展，是公司业务发展、产业升级的现实需求，符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向。

通过本次募集资金投资项目的实施，围绕公司核心业务布局，重点扩产高多层板和 HDI 板等高端产能，项目将通过引入智能化设备、优化生产工艺、突破关键技术瓶颈，满足工控、汽车电子产能需求的同时，突破服务器、光模块等前沿应用领域对高端 PCB 的需求，有利于公司进一步巩固和提升技术先进性、产品竞争力和品牌形象，同时有助于充实公司资本实力，优化公司财务结构，

提高抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

本次募投项目与公司当前主营业务方向相符合，有利于公司巩固行业地位，进一步提升公司的技术水平和服务能力，从而进一步增强公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司战略发展目标。

## （二）本次募投项目与公司前次募投项目的关系

本次募投项目年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）与年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板）的联系与区别如下：

| 项目     | 区别                                                                                                           |                                                                                                              | 联系                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        | 前次募投项目                                                                                                       | 本次募投项目                                                                                                       |                                              |
| 产品类型   | 刚性板为主、HDI 板为辅                                                                                                | 刚性板、HDI 板                                                                                                    | 均包含刚性板、HDI 板                                 |
| 产品层数   | 以 2 层、4 层刚性板为主，占比为 69%；6 层及以上刚性板、HDI 为辅，占比为 31%                                                              | 以 6 层及以上刚性板、HDI 板为主                                                                                          | 均包含多层板、HDI 板                                 |
| 产品性能参数 | 最高层数：100L<br>内层最小线宽线距：0.035/0.035mm<br>外层最小线宽线距：0.035/0.035mm<br>激光钻孔最小孔径：0.075mm<br>最大铜厚：230Z<br>最大厚径比：25:1 | 最高层数：110L<br>内层最小线宽线距：0.025/0.025mm<br>外层最小线宽线距：0.025/0.025mm<br>激光钻孔最小孔径：0.050mm<br>最大铜厚：250Z<br>最大厚径比：30:1 | 本次募投项目产品与前次募投在通用性产品性能方面不存在本质差异，在相关技术参数方面有所升级 |
| 生产设备   | 主要设备包括机械钻孔机、激光钻孔机、真空压机、AOI 检测、电镀线、喷印机、棕化机、防焊显影机、曝光机、激光直接成像设备、压合机等                                            | 增加配套现有设备，在制程能力、精度工艺、过程控制存在升级或优化，生产精度及产线整体自动化能力进一步提升                                                          | 主要生产设备类型不存在显著差异                              |
| 生产工艺   | 包括钻孔、电镀、线路等工序，涉及细线路制作（线宽线距为 3mil）、阻抗公差管控等工艺控制技术                                                              | 进一步提升高多层板和 HDI 板的生产工艺，提升产品的线路精细度（线宽线距 1.0mil~2mil）、阻抗一致性等性能                                                  | 均包括钻孔、电镀、线路等工序，在生产工艺方面具有共通性                  |
| 客户群体   | 主要为工业控制、汽车电子领域终端品牌客户等                                                                                        | 主要面向服务器、光模块等新兴领域新客户，同时兼顾工业控制、汽车电子等现有客户高端产品需求                                                                 | 基于现有客户的新增需求、同时积极拓展新客户                        |
| 应用领域   | 工业控制（伺服电机、工控电源等）、汽车电子（车载雷达、充电模块、汽车大灯等）以及通信设备等应用领域                                                            | 在现有产品应用领域基础上，进一步增加服务器（CPU、DPU、内存条、加速板、AI 电源等）、光模块、新能源汽车电子（ADAS、BMS、三电系统、激                                    | 本次募投项目在应用领域与现有业务有所交集，在既有领域基础上，聚焦新兴及高增长细分     |

| 项目   | 区别     |                      | 联系                 |
|------|--------|----------------------|--------------------|
|      | 前次募投项目 | 本次募投项目               |                    |
|      |        | 光雷达等)、机器人、无人机等应用领域占比 | 市场，实现对现有应用体系的纵向深化。 |
| 实施地点 | 四会市下茆镇 | 四会市龙甫镇               | 均在四会市              |

公司本次募投项目与前次募投项目的联系在于两者均系围绕公司主营业务、扩大公司产品产能开展，以增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，在生产设备、生产工艺和客户群体形成衔接和提升。公司本次募投项目旨在巩固原有产品和应用领域的同时，加大对服务器和光模块领域的市场开拓力度。

综上，本次募投项目与前次募投项目均投向公司主业，在产品类型、应用领域、产品层数、生产设备、生产工艺等方面有所区别，不存在重复建设的情形。

### （三）扩大业务规模的必要性

公司年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）属于在现有技术和项目实践经验的基础上进行产品结构升级与转型，属于扩大业务规模，必要性分析详见本募集说明书“第四节·二·（二）本次募集资金投资项目的必要性”。

### （四）新增产能规模的合理性

详见本募集说明书“第四节·二·（二）·1、顺应高端 PCB 市场结构性高速增长的核心趋势，抢占未来增长主赛道”和“第四节·二·（二）·3、把握 AI 算力爆发与硬件迭代的历史性机遇，切入高附加值客户供应链”。

## 五、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响

### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金均用于公司主营业务，项目实施后，公司的业务范围不会发生重大变化，不涉及公司业务与资产的整合，但将丰富公司产品线，丰富产业生态，增强业务竞争力。

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，资本实力和

抗风险能力将得到提升，符合公司及全体股东的利益。

## **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司净资产及总资产规模将相应增加，资金实力将明显提升，风险抵抗能力进一步增强，为后续业务扩展提供良好的保障。

## **六、募投项目实施后新增同业竞争或关联交易的情况**

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争不会因本次发行而发生重大变化。本次向特定对象发行也不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。

## **七、募集资金投资项目涉及报批事项情况**

截至本募集说明书出具日，公司取得了肇庆市生态环境局关于项目环境影响报告表的批复，已完成项目备案的相关工作，募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律、法规和规章的规定。

## **八、募集资金投资项目可行性分析结论**

公司本次向特定对象发行 A 股股票具备必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，本次发行将有利于进一步完善公司产业布局，提高公司经营业绩，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。

## 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

### 一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

#### （一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金均用于公司主营业务，项目实施后，公司的业务范围不会发生重大变化，不涉及公司业务与资产的整合，但将丰富公司产品线，丰富产业生态，增强业务竞争力。

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，资本实力和抗风险能力将得到提升，符合公司及全体股东的利益。

#### （二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中的与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

#### （三）本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司股本将增加，原股东的持股比例也将相应发生变化，但公司控股股东、实际控制人仍保持不变。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变更。

本次发行完成后，不会导致公司股权分布不具备在深交所的上市条件。

#### （四）本次发行对高级管理人员结构的影响

本次发行完成后，公司预计不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### （五）本次发行对业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，相关项目实施完成后带来的收入仍为公司原有主营业务收入。公司的业务结构不会因本次发行而发

生重大变化。

## **二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况**

### **（一）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司净资产及总资产规模将相应增加，资金实力将明显提升，风险抵抗能力进一步增强，为后续业务扩展提供良好的保障。

### **（二）本次发行对公司盈利能力的影响**

本次发行完成后，公司总股本将有所增加，资本规模进一步扩大。本次募集资金均投向公司主营业务，用于公司未来发展的战略布局。但由于公司募投项目的建设和生产需要一定时间，募投项目效益在短时间内无法完全体现，因此本次向特定对象发行完成后，短时间内发行人的净资产收益率及每股收益指标将被摊薄。

从长远来看，本次募集资金投资项目的实施将对公司主营业务的发展产生积极影响，有利于提升公司的综合竞争力，随着募集资金投资项目预期效益的实现，公司的盈利能力将会进一步增强。

### **（三）本次发行对公司现金流量的影响**

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司筹资活动现金流入将大幅增加，同时随着募投项目的建设，公司投资活动现金流出也将相应增加。待公司募投项目投入运营并产生效益后，公司的竞争实力不断提升，将有助于扩大公司经营活动现金流入规模。

## **三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况**

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争不会因本次发行而发生重大变化。本次向特定对象发行也不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。

#### **四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形**

截至本募集说明书签署日，本公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。

本次发行不会导致公司资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，也不会产生公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

公司将严格执行国家有关法律法规，杜绝违规资金占用和违规担保行为，以确保广大投资者的利益。

#### **五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况**

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将增加，资产负债率会随之下降，财务结构将进一步优化，抗风险能力将进一步增强，实现长期可持续发展。本次发行不会导致公司大量增加负债以及或有负债的情况，也不存在导致公司负债比例过低、财务成本不合理的情况。

第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

按前次募集资金到账时间计算，最近五年内，公司进行过一次募集资金行为，具体如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522 号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,700,000 张，每张面值为 100.00 元，募集资金总额为人民币 570,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,780,406.65 元，实际募集资金净额为人民币 562,219,593.35 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779 号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、前次募集资金基本情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用前次募集资金为人民币 46,428.38 万元，均投入募集资金项目，累计使用募集资金占实际募集资金净额的比例为 82.58%。募集资金未使用完毕的原因是项目尚在建设中，尚未完成投资，剩余资金将继续用于募集资金项目建设。公司前次募集资金使用和结存情况如下：

单位：万元

| 项目                                                     | 金额        |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金净额                                                 | 56,221.96 |
| 减：募集资金累计投入                                             | 46,428.38 |
| 其中：四会富仕电子科技有限公司年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板） | 33,690.47 |
| 四会富仕电子科技有限公司补充流动资金                                     | 12,737.91 |
| 减：银行手续费                                                | 0.17      |
| 加：募集资金利息收入及理财收益                                        | 1,516.50  |
| 2026 年 6 月 30 日募集资金余额                                  | 11,309.91 |
| 其中：购买理财产品                                              | 6,000.00  |
| 募集资金专户余额                                               | 5,309.91  |

公司承诺投资 2 个项目为年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板）和补充流动资金项目，前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

|                    |                                         |                                         |                   |             |             |                   |             |             |                        |                  |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| 募集资金总额：56,221.96   |                                         |                                         |                   |             |             | 已累计使用募集资金总额：      |             |             | 46, 428. 38            |                  |
| 变更用途的募集资金总额：0.00   |                                         |                                         |                   |             |             | 各年度使用募集资金总额：      |             |             |                        |                  |
|                    |                                         |                                         |                   |             |             | 2023 年：           |             |             | 18,901.41              |                  |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 |                                         |                                         |                   |             |             | 2024 年：           |             |             | 8,786.09               |                  |
|                    |                                         |                                         |                   |             |             | 2025 年：           |             |             | 8,868.36               |                  |
|                    |                                         |                                         |                   |             |             | 2026 年 1-6 月：     |             |             | 9, 872. 52             |                  |
| 投资项目               |                                         |                                         | 募集资金投资总额          |             |             | 截止日募集资金累计投资额      |             |             |                        | 项目达到预定可以使用状态日期   |
| 序号                 | 承诺投资项目                                  | 实际投资项目                                  | 募 集 前 承 诺 投 资 金 额 | 募集后承 诺投资金 额 | 实 际 投 资 金 额 | 募 集 前 承 诺 投 资 金 额 | 募集后承 诺投资金 额 | 实 际 投 资 金 额 | 实际投资金额 与募集后承 诺投资金额的 差额 |                  |
| 1                  | 年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板） | 年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板） | 43,500.00         | 43,500.00   | 33, 690. 47 | 43,500.00         | 43,500.00   | 33, 690. 47 | 9, 809. 53             | 2027 年 12 月 31 日 |
| 2                  | 补充流动资金                                  | 补充流动资金                                  | 12,721.96         | 12,721.96   | 12,737.91   | 12,721.96         | 12,721.96   | 12,737.91   | -15.95                 | -                |
| 合计                 |                                         |                                         | 56,221.96         | 56,221.96   | 46, 428. 38 | 56,221.96         | 56,221.96   | 46, 428. 38 | 9, 793. 58             |                  |

注：年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板）项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异，主要系项目正在建设中，资金尚未使用完毕；补充流动资金项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异主要系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

发行人前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

| 实际投资项目 |                                         | 截止日投资项目累计产能利用率 | 累计承诺效益（利润） | 最近三年及一期实际效益 |        |        |              | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|-----------------------------------------|----------------|------------|-------------|--------|--------|--------------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称                                    |                |            | 2023 年      | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 1-6 月 |           |          |
| 1      | 年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板） | 不适用            | 不适用        | 不适用         | 不适用    | 不适用    | 不适用          | 不适用       | 不适用      |
| 2      | 补充流动资金                                  | 不适用            | 不适用        | 不适用         | 不适用    | 不适用    | 不适用          | 不适用       | 不适用      |

注：1、年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板）项目尚未达到预定可使用状态，目前尚处于建设阶段，无法进行效益测算。

2、“补充流动资金”目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营稳定性，无法单独核算效益。

前次募投项目为更好地适应市场需求，实现分步骤有序达成产能升级、扩

容目标，并降低募集资金投资风险和经营风险、保障资金的安全和合理运用，提升资金使用效率，公司审慎控制了项目投资建设进度，将项目设备投资完成时间由 2025 年 12 月延长至 2026 年 12 月、达产时间由 2026 年 12 月延长至 2027 年 12 月。公司已于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该延期事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。目前该项目尚处于建设阶段，无法进行效益测算。

“补充流动资金”项目不直接产生效益，因此无法单独核算效益。募集资金用于该项目有利于提高公司的抗风险能力，增强核心竞争力，保持公司经营稳定性，促进公司可持续发展。

#### **四、尚未使用的前次募集资金的后续使用计划**

公司尚未使用的前次募集资金严格按照募集资金专款专用的原则使用，后续将按照投入计划持续投入相应的前次募集资金项目。

#### **五、前次募集资金投资项目变更情况**

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目未发生变更。

#### **六、闲置募集资金的使用情况**

2023 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过 R1)在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2024 年 8 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过 R1)在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过 R1)在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

单位：万元

| 序号 | 购买主体 | 受托方            | 产品名称                     | 产品类型  | 购买金额     | 起息日       | 到期日       | 预期年化收益率     | 资金来源   |
|----|------|----------------|--------------------------|-------|----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 1  | 四会富仕 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2026/6/29 | 2026/7/29 | 1.00%~1.40% | 闲置募集资金 |
| 合计 |      |                |                          |       | 6,000.00 | -         | -         | -           | -      |

## 七、会计师事务所出具的专项报告结论

立信会计师事务所对《四会富仕电子科技有限公司截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《四会富仕电子科技有限公司截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2026]第 Z110768 号），发表意见为：“四会富仕截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定编制，如实反映了四会富仕公司截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况。”

## 八、超过五年的前次募集资金用途变更情况

截至本募集说明书签署日，公司超过五年的前次募集资金情况仅为 2020 年首次公开发行股票，公司首次公开发行股票募集资金未发生用途变更的情况。

## 第七节 与本次发行相关的风险因素

投资者在评价发行人本次向特定对象发行 A 股股票时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。

### 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

#### （一）宏观经济波动风险

公司主营业务为各类印制电路板的研发、生产与销售业务，印制电路板作为电子元器件基础行业，PCB 行业的发展与电子信息产业及宏观经济形势密切相关，尤其是随着电子信息产业国际化程度的提高，PCB 需求受全球市场环境影响较大。宏观经济波动对 PCB 下游行业如工业控制、汽车电子、服务器、通信设备、医疗器械、光模块等都将产生不同程度的影响，进而影响 PCB 行业的需求增长。如果未来全球地缘政治风险上升，贸易保护主义抬头以及下游行业出现周期性波动，或国家财政、货币、贸易等宏观政策发生不利调整，可能对公司经营业绩产生一定影响。

#### （二）行业产能大幅扩张导致产品价格下降的风险

近年来，全球 PCB 产能不断向国内聚集，我国已成为全球印刷线路板的主要生产基地。近几年国内 PCB 产能仍处于快速扩张态势，若未来出现行业产能过剩、行业竞争加剧导致产品价格下滑，公司未能持续提高公司的技术水平、生产管理、产品质量以应对市场竞争，则存在盈利下滑的风险。

#### （三）原材料供应紧张及价格波动风险

公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、金盐、半固化片、铜箔等，主要原材料价格受国际市场铜、金等大宗商品的影响较大。若未来原材料供应紧张、价格大幅上涨，而公司不能通过提高产品价格向下游客户转嫁原材料涨价成本，或通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，可能出现原材料供应不足或盈利能力下降等情形，将对公司的经营成果产生不利影响。

#### （四）市场竞争风险

PCB 行业竞争激烈，行业格局正朝着“大型化、集中化”方向发展。行业龙头企业通过技术创新、规模扩张及供应链整合不断增强市场影响力，而中小企业则面临更大生存压力。若公司未能及时把握市场机遇，持续进行资金投入及技术研发，快速适应产品开发和市场策略的变化，可能会在市场竞争中失去优势，出现订单下滑、收入利润下降进而导致市场份额缩减的风险。

#### （五）财务风险

##### （1）毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 27.11%、22.82%、20.77%和 **20.94%**，受行业竞争激烈、泰国子公司一品电路产能爬坡、原材料价格上涨等因素影响，公司综合毛利率整体呈下降趋势。

**2025 年以来，受国际贵金属价格持续上涨、高端电子布产能刚性紧缺等多重因素共振，覆铜板行业进入强景气上行周期，带动整个 PCB 上游材料板块进入系统性涨价周期，在原材料端面临系统性价格上涨的背景下，发行人的成本传导机制存在时滞，产品结构转型期高端产品贡献尚在爬坡阶段，如果未来受下游终端客户订单需求变动、议价能力提升、市场竞争加剧等导致公司产品销售价格下降，而公司未能及时通过提高技术水平、产品质量、提高产能利用率以应对市场竞争，或者原材料价格上升，短期内难以逆转，而公司未能有效控制产品成本等情况发生，则存在毛利率波动和盈利能力波动或下滑的风险。**

##### （2）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 13,376.67 万元、16,258.06 万元、29,504.60 万元和 **38,652.43 万元**。报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 653.48 万元、988.93 万元、1,987.29 万元和 **1,657.71 万元**，占当期存货余额的比重分别为 4.66%、5.73%、6.31%和 **4.11%**。报告期内，公司销售规模逐年增长，公司根据销售订单情况提前备货，导致存货余额及跌价准备计提增加。随着市场价格的波动，公司存在存货跌价损失加大的风险，可能给公司经营业绩和财务状况带来不利影响。

##### （3）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 32,033.77 万元、34,202.55 万元、52,415.72 万元和 **62,303.01 万元**，各期末应收账款余额呈现增长趋势，占营业收入的比例分别为 24.37%、24.20%、27.13%和 **50.55%**。随着市场竞争的加剧、经营规模的扩大和新业务的不断开展，公司客户数量及应收账款余额将可能持续增长，如果部分客户出现支付困难、拖延付款等现象，公司将面临无法及时收回货款的风险，从而对公司的资金周转和生产经营产生不利影响。

#### **（六）税收优惠政策变动风险**

2025 年 12 月，公司再次通过高新技术企业认定，有效期三年。根据国家对于高新技术企业的相关优惠政策，公司所得税适用 15%的优惠税率。

如果有关高新技术企业税收优惠政策发生变化，或公司不再符合高新技术企业税收优惠条件，使得公司不能继续享受 15%的优惠所得税税率，公司的所得税费用将大幅上升，盈利水平将受到不利影响。

#### **（七）技术持续研发迭代风险**

近年来，AI 等新兴领域技术快速发展，一方面为 PCB 行业带来新的机遇，另一方面对 PCB 产品的技术要求亦相应提高。目前，下游客户对 PCB 产品的集成度、高速信号传输能力、可靠性、散热性等要求持续提升，PCB 产业正朝着满足下游更复杂化电路布局及更高性能计算需求的方向发展。同时，PCB 是一个多学科交叉的复合型高科技行业，具有很高的技术难度。PCB 制造融合了电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多门学科，技术集成度高、开发难度大，需要经过长期的学习和积累，并将理论知识转化为实际生产能力，才能保证产品生产的稳定性和连续性。因此，PCB 生产企业必须具备很强的技术水平和研发能力才能及时研发和生产出符合客户需求的产品，适应电子产品不断创新变化的发展趋势。同时，PCB 产品的制造过程工序众多、工艺复杂，每个工序参数的设置要求严格，对产品精密度要求高，企业必须同时具备良好的理论水平、长期的经验积累、先进的生产工艺才能制造出高性能、高精度的产品。

未来如果公司在研发上投入不足，或者研发方向出现误判，导致公司未能及时跟上行业技术创新趋势，在关键技术研发、工艺升级及产品迭代上未能及时满足客户需求，则可能面临产品竞争力下降、客户资源流失等风险，对公司

经营业绩产生不利影响。

### （八）核心技术人员流失风险

公司所处印制电路板行业具有一定的技术壁垒，核心技术人员是公司进行产品研发的核心保障，是公司掌握印制电路板相关技术、获取自主知识产权的重要依赖，也是维持并提升公司核心竞争力的源动力。未来若因市场环境变化、薪酬激励机制不足等原因，导致核心管理人员与研发技术人员流失，则可能对公司的业务发展造成不利影响。

### （九）汇率波动风险

汇率波动对公司的影响主要体现在：一方面，受人民币汇率波动影响，以本币计量的营业收入变化，对主要产品的毛利水平产生直接影响；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，亦直接影响公司业绩。

报告期，公司出口销售收入占主营业务收入的比例较大。若未来人民币出现大幅升值，一方面会导致公司汇兑损失增加，另一方面相对国外竞争对手的价格优势可能被减弱，假设在外币销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入减少，可能对公司经营业绩造成不利影响。

### （十）人工成本上升的风险

随着公司业务规模扩张，尤其在产能提升及市场需求增长的背景下，公司对劳动力的需求持续增加。若用工成本大幅上升，而公司未能通过自动化生产技术优化人力需求或提升生产效率，可能对成本结构和盈利能力产生不利影响。在全球劳动力成本上升及行业竞争加剧的情况下，较高的用工成本可能进一步压缩公司利润空间，影响持续盈利能力和市场竞争力。

## 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

### （一）本次发行的审批风险

本次向特定对象发行 A 股股票尚需取得中国证监会同意注册的批复，能否取得有关主管部门的批准，以及最终取得上述批准的时间存在不确定性。

## （二）发行风险

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，且最终根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定，发行价格不低于定价基准日（即发行期首日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的百分之八十。本次发行的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次发行存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

## （三）股价波动风险

股票市场投资既包含潜在收益，也伴随一定风险。公司股票价格的波动不仅取决于自身盈利水平和发展前景，还受到宏观经济政策调整、金融政策调控、市场供需变化、投资者情绪及市场投机行为等多种因素的影响。这些因素可能导致股价波动，从而给投资者带来一定风险。

此外，本次向特定对象发行股票需经过相关监管部门的审批，审批流程存在一定周期。在此期间，公司股票市场价格可能因市场环境变化或投资者预期调整而产生波动，增加投资者的不确定性风险。

# 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素

## （一）募集资金投资项目实施风险

由于募投项目的实施需要一定时间，期间宏观政策环境的变动、行业竞争情况等因素会对募集资金投资项目的实施产生较大影响。此外，在项目实施过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟实施等不确定性事项，也会对募集资金投资项目的实施效果和预期效益带来较大影响。

## （二）募投项目收益不及预期的风险

公司本次募集资金用于“年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）”，本次募投项目达产后实现不含税年销售收入 109,206.00 万元，年利润总额（税前）11,937.04 万元。未来整体市场环境、供求关系尚存在不确定性，若在募投项目实施过程中宏观经济、

产业政策、市场需求等发生重大不利变化，可能出现行业产能过剩、行业竞争加剧的情形，或者产品技术路线发生重大更替、公司市场开拓不力、无法满足下游客户需求或其他不可抗力因素出现，都可能对公司募投项目投产后的产能消化、产品销售价格和毛利率等造成不利影响，进而可能导致募集资金投资项目实际效益不及预期。

### （三）新增产能消化风险

公司本次募集资金投向围绕公司 PCB 主业进行布局，旨在增加公司高多层板及 HDI 产能。项目建成达产后，将形成年产 60 万平方米高多层及 HDI 电路板产能。当前较多同行业公司普遍在进行规模扩张，**东山精密、广合科技、沪电股份、鹏鼎控股、胜宏科技、深南电路等头部厂商资本开支呈加速态势，均在同步进行以高多层板和 HDI 板为核心方向的大规模产能建设，积极增加产能，现阶段行业呈现集中扩产态势，产能集中释放的累积效应预计在 2-3 年集中显现，与发行人本次募投项目的投产时间窗口存在一定重叠，未来可能因新增产能陆续释放引发供给过剩而需求不足的风险，可能对募投项目产能消化形成压力。本次募投项目重点布局的服务器和光模块等新兴领域的技术门槛高、存量头部企业先发优势明显，公司短期内实现大规模订单落地的确定性有限。如果本次募集资金投资项目建成投产后，PCB 行业出现下游需求增长放缓甚至下滑、行业内同质化竞争加剧、新增产能投产速度过快、重大技术革新并形成替代、下游市场需求发生重大变化、公司客户开拓力度不及预期或其他重大不利变化的情形，可能导致市场需求增长不及预期以及产品推广困难，进而可能导致公司募投项目新增产能无法及时消化，本次募投项目新增产能的消化面临一定的产能闲置风险。**

### （四）固定资产折旧增加对公司经营业绩产生不利影响的风险

公司本次募集资金拟投向“年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）”，公司计划投入较大金额用于设备采购和工程建设等资本性支出。公司本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产较本次发行前将有所增加，**本次募投项目聚焦的高多层板及 HDI 板工艺复杂度高、客户认证壁垒严、良率爬升难度大，产能爬坡周期长达 3 年，由此带来每年固定资产折旧、无形资产摊销的增长，预计达产年度新增折旧及**

摊销金额为 7,211.20 万元。投产初期折旧计提与收入贡献之间存在明显的时间错配，导致投产初期项目利润为负，募集资金投资项目的建设需要一定的周期，折旧及摊销为固定成本，其对利润的影响具有杠杆效应，在产能利用率不足的情形下，单位产品折旧成本被动抬升，项目盈利空间将被压缩，新增折旧摊销将对发行人盈利能力构成结构性侵蚀，合并报表层面面临利润承压风险。若本次募投项目建设过程中公司经营环境发生重大不利变化或者募投项目建成后经济效益不及预期，募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

### **（五）即期回报被摊薄的风险**

本次发行的募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量有所提高，募集资金投资项目释放经济效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。若募集资金使用效益短期内难以全部实现，或公司利润增长幅度将小于净资产和股本数量的增长幅度，公司的每股收益和加权平均净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。

### **（六）管理风险**

本次募集资金投资项目实施后，公司将进一步拓展经营业务，形成更加良好的经营局面，这对公司管理团队的能力提出了更高要求。公司将在战略规划、制度建设、组织架构、运营管理、资金管理以及内部控制等多个方面面临更为复杂和严峻的挑战。如果公司未能高效且高质量地执行发展战略，导致运营能力与实际业务布局需求不匹配，可能影响公司整体运营效率与市场竞争力。

## 第八节 与本次发行相关的声明

### 一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

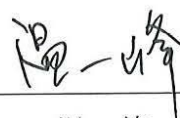
全体董事签字：



刘天明



黄倩怡



温一峰



黄骏宇



陈世荣



徐继宏

高级管理人员签字：



刘家平



方浩东



黄倩怡



谭丹

四会富仕电子科技有限公司



2026 年 9 月 11 日

## 发行人审计委员会声明

公司审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

审计委员会委员签字：

徐继宏

徐继宏

陈世荣

陈世荣

温一峰

温一峰

四会富仕电子科技有限公司



2026年9月11日

## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：四会市明诚贸易有限公司



控股股东法定代表人：

温一峰  
温一峰

实际控制人：

刘天明

刘天明

黄志成

黄志成

温一峰

温一峰

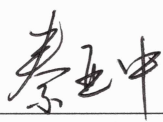
四会富仕电子科技有限公司

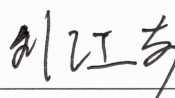


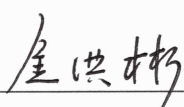
2026年9月11日

### 三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：   
秦亚中

  
刘江奇

项目协办人：   
金洪彬

法定代表人：   
徐春

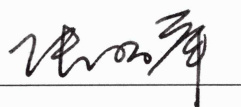
国联民生证券承销保荐有限公司



## 保荐人总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人总经理签名：



张明举



## 保荐人董事长声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人董事长签名：



徐春

国联民生证券承销保荐有限公司

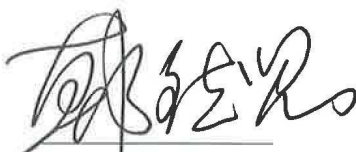


2026年9月11日

#### 四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《四会富仕电子科技有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签字）：

  
韩德晶

经办律师（签字）：

  
黄亚平

  
罗增进



## 五、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读四会富仕电子科技有限公司的募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对四会富仕电子科技有限公司在募集说明书中引用的审计报告等文件内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



邢向宗



王 佳

会计师事务所负责人：



杨志国



立信会计师事务所（特殊普通合伙）



2026 年 9 月 11 日

## 六、发行人董事会声明

### （一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

除本次发行外，公司将根据业务发展规划、项目投资进度等情况，并结合公司资本结构、融资成本等因素综合考虑是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律、法规履行相关审议程序和信息披露义务。

### （二）关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施

#### 1、大力推进募投项目建设，增强公司盈利能力

公司董事会已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次发行募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益。

#### 2、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》并将依此严格管理募集资金。同时，公司将合理安排项目投资进度，提升募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设以如期实现本次募投项目的投产，尽早产生效益以回报公司股东。

#### 3、优化投资回报机制

为了积极回报投资者、保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已制定《四会富仕电子科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》，对公司利润分配、未来分红回报规划作出了明确规定，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。同时公司也建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制等。届时，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者的相关合法权益，有效维护和增加对投资者的回报。

#### 4、进一步加强经营管理和内部控制，为公司发展提供保障

本次发行完成后，公司的业务规模将持续提升、财务状况将进一步优化，公司的抗风险能力及核心竞争力也将得到进一步增强。

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，不断加强公司经营管理，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，进一步维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司长期稳定的发展提供坚实的制度保障。

上述填补回报措施不等于对公司未来的利润情况做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担相关赔偿责任，敬请广大投资者注意相关的投资风险。

### **（三）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺**

#### **1、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺**

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东四会市明诚贸易有限公司，实际控制人刘天明、温一峰、黄志成承诺如下：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本承诺出具后至本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求且上述承诺不再满足相关规定的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

3、本公司/本人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意根据相关法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。”

#### **2、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺**

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、本人承诺如公司未来实施股权激励计划，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、本承诺出具后至本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求且上述承诺不再满足相关规定的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
- 7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。”

（本页无正文，为《四会富仕电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书董事会声明》之盖章页）

四会富仕电子科技股份有限公司董事会

